

雍智科技股份有限公司

KEYSTONE MICROTECH CORPORATION

公開說明書

(發行一一三年限制員工權利新股)

- 一、 公司名稱：雍智科技股份有限公司
- 二、 本公開說明書編印目的：發行一一三年限制員工權利新股。
 - (一)發行種類：本辦法規定之限制員工權利新股一旦發行後，除依本辦法交付信託保管及依本辦法規定未達既得條件前受限制之權利外，其權利與本公司已發行之普通股股票相同。
 - (二)發行股數及金額：發行總數計 180,000 股，每股面額新台幣壹拾元整，發行總額新台幣 1,800,000 元。
 - (三)發行價格：每股發行價格新台幣 0 元，即無償發行。
 - (四)發行條件：請參閱本公開書明書附件一。
- 三、 本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。
- 四、 本次發行之相關費用：
 - (一)承銷費用：不適用。
 - (二)其他費用：包含會計師及其他相關費用，合計約新台幣 160 仟元。
- 五、 有價證券之生效(核准)，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 六、 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 七、 投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項，請參閱本公開說明書第 2 頁至第 7 頁。
- 八、 查詢本公開說明書之網址：
 - (一) 公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>。
 - (二) 公司網站 <https://www.ksmt.com.tw/>

雍智科技股份有限公司 編製
中華民國 113 年 03 月 25 日 刊印



一、本次發行前實收資本額之來源：

單位：新台幣元

資本來源	金額	占實收資本額比率
設立資本	63,500,000	23.33%
現金增資	35,010,000	12.86%
盈餘轉增資	157,816,610	57.98%
庫藏股註銷股份	(570,000)	(0.21%)
員工認股權行使所發行股份	15,000,000	5.51%
發行限制員工權利新股	1,420,000	0.52%
合計	272,176,610	100.00%

二、公開說明書之分送計劃：

(一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。

(二)分送方式：依公開發行公司相關法令規定辦理。

(三)索取公開說明書方法：請上網至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢及下載。

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：不適用。

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

網址：<http://www.kgi.com>

地址：台北市重慶南路一段2號5樓

電話：(02)2389-2999

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名：陳重成會計師、陳薔甸會計師

地址：台北市信義區松仁路100號20樓

電話：(02)2725-9988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：黃榮彬

代理發言人姓名：林詩堯

職稱：協理

職稱：經理

電話：(03)550-9980#6150

電話：(03)550-9980

電子郵件信箱：Robin.Huang@ksmt.com.tw 電子郵件信箱：Kevin.Lin@ksmt.com.tw

十三、公司網址：<http://www.ksmt.com.tw>

雍智科技股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：272,176,610 元		公司地址：新竹縣竹北市莊敬北路 431 號		電話：(03)550-9980
設立日期：民國 95 年 9 月 11 日			網址：http://www.ksmt.com.tw	
上市日期：不適用		上櫃日期：108 年 4 月 23 日	公開發行日期：107 年 4 月 13 日	管理股票日期：不適用
負責人：董事長 李職民			發言人：黃榮彬 代理發言人：林詩堯	職稱：協理 職稱：經理
股票過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部			電話：(02) 2389-8999 網址：http://www.kgi.com 地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓	
股票承銷機構：不適用			電話：— 地址：	網址：—
最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 陳重成會計師、陳蕃旬會計師			電話：(02) 2725-9988 網址：http://www.deloitte.com.tw 地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓	
複核律師姓名：不適用			電話：— 地址：—	網址：—
信用評等機構：不適用			電話：— 地址：—	網址：—
評等標的	發行公司：不適用		無■；有□，評等日期：不適用	評等等級：不適用
	本次發行公司債：不適用		無■；有□，評等日期：不適用	評等等級：不適用
董事選任日期：110 年 08 月 02 日，任期：3 年			監察人選任日期：不適用。	
全體董事持股比例：15.98%（113 年 2 月 29 日）			全體監察人持股比率：不適用(本公司設置審計委員會)。	
董事及持股超過 10%股東及其持股比例：（113 年 2 月 29 日）				
	職 稱	姓 名	持股比例	
	董事長	李職民	2.20%	
	董事	寬逸投資有限公司	11.38%	
	董事	盧俊郎	1.33%	
	董事	葉啟鴻	1.07%	
	獨立董事	林江亮	0.00%	
	獨立董事	陳啟文	0.00%	
	獨立董事	陳金漢	0.00%	
工廠地址：新竹縣竹北市莊敬北路 431 號			電話：(03)550-9980	
主要產品：IC 測試載板及相關測試板			市場結構：(112 年度) 內銷 53.36%； 外銷 46.64%	參閱本文之頁次 第 26 頁
風 險 事 項	請參閱本公開說明書公司概況之風險事項			參閱本文之頁次 第 2~7 頁
去（112）年度	營業收入：1,410,225 仟元 稅前純益：442,710 仟元 每股稅後盈餘：13.07 元			第 29~35 頁
本次募集發行有價證券種類及金額	請參閱本公開說明書封面			
發 行 條 件	請參閱本公開說明書封面			
募 集 資 金 用 途 及 預 計 產 生 效 益 概 述	不適用			
本次公開說明書刊印日期：113 年 03 月 25 日			刊印目的：發行民國一一三年度限制員工權利新股	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄				

公開說明書目錄

壹、公司概况	1
一、公司簡介	1
(一)設立日期	1
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話	1
(三)公司沿革	1
二、風險事項	2
(一)風險因素	2
(二)訴訟或非訟事件	6
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及 截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明 其對公司財務狀況之影響	6
(四)其他重要事項	6
三、公司組織	8
(一)關係企業圖	8
(二)董事資料	9
四、資本及股份	13
(一)股本形成經過	13
(二)最近股權分散情形	14
(三)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料	15
(四)公司股利政策及執行狀況	15
(五)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	16
(六)員工、及董事酬勞	16
貳、營運概況	20
一、公司之經營	20
(一)業務內容	20
(二)市場及產銷概況	28
二、轉投資事業	31
(一)轉投資事業概況	31
(二)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分 本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效 及財務狀況之影響：無此情形。	33
三、重要契約	33
參、發行計劃及執行情形	33
一、本次發行限制員工權利新股應記載事項	33
二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項	33
三、本次併購發行新股應記載事項	33
肆、財務概況	34
一、最近五年度簡明財務資料	34
二、財務報告應記載事項	42
(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告， 並應加列最近一季依法公告申報之財務報告	42
(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告。	42
(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經	

會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：	42
三、財務概況其他重要事項應記載事項	42
四、財務狀況及經營結果檢討分析	42
(一)財務狀況	42
(二)財務績效	42
(三)現金流量	44
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響	44
(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	45
(六)其他重要事項	45
伍、特別記載事項	46
一、內部控制制度執行狀況	46
二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：	46
三、證券承銷商評估總結意見：	46
四、律師法律意見書：	46
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：	46
六、本次募集與發行有價證券於申報生效時經本會通知應補充揭露之事項：	46
七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：	46
八、第一上市（櫃）公司及興櫃公司與我國股東權益保障規定重大差異之說明：	46
十一、公司治理運作情形	47
(一)董事會運作情形	47
(二)審計委員會運作情形	48
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	52
(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形	56
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	57
(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：	66
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式	68
(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形	68
(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊	68

附件一 113 年度限制員工權利新股發行辦法

附件二 會計師複核之案件檢查表彙總意見

附件三 111 年度財務報表暨會計師查核報告

附件四 112 年度合併財務報表暨會計師查核報告

附件五 112 年度個體財務報表暨會計師查核報告

壹、公司概況

一、公司簡介

本公司提供之產品與服務在半導體供應鏈中屬於 IC 測試產業一環，所提供的產品與服務從前段測試載板（晶圓探針卡測試載板）、後段測試載板（IC 測試載板及 IC 老化測試載板）及其他相關測試載板等項目。我們長期與客戶一起發展，累積深厚的測試整合技術和經驗，提供客戶兼具成本效率與完整可靠的測試解決方案。

(一)設立日期

民國 95 年 9 月 11 日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

名稱	地址	電話
總公司	新竹縣竹北市莊敬北路431號	(03)550-9980
分公司	無	無
工廠	新竹縣竹北市莊敬北路431號	(03)550-9980

(三)公司沿革

年度	重要發展記事
95 年度	雍智科技(股)公司正式成立，實收資本額為新台幣63,500仟元。 推出RF Loadboard解決RF晶片FT量產產能瓶頸，建立國內自行設計RF L/B能力。
96 年度	推出首創DDR3 1866Mbps懸臂式探針卡供給記憶體大廠先進製程工程開發用。 推出DDR2/DDR3記憶體量產測試用socket board。 與日本Yokowo合作推出首款coaxial socket RF探針卡。
97 年度	推出DDR/LVDS/HDMI 等高速FPGA模組，成功導入DTV類型晶片FT量產，除了可活化低階機台架動率，並成功提升高速數位測試載板市佔率。 投資設立毓祥科技股份有限公司，專司PCB工程設計及製造服務。
100 年度	推出高階AP/Baseband Load Board 建立大電流低電壓高速PCB設計生產能力。 投資設立銳萊科技股份有限公司，專門提供RF通訊模組及系統。
101 年度	成立台南辦公室。 推出首款手機晶片POP封裝測試載板，整合O/S與full-speed LPDDR2測試可一站完成。
102 年度	設立上海辦事處，就近服務大陸客戶。 開發完成飛針測試機台，確保組裝品質與電氣特性測試一致性，提供更完整驗證測試及完善的產品維修能力。
103 年度	建立量測檢驗室，量測探針卡板平、板厚等精密機構尺寸。 推出multi-dut RF/PMIC WLCSP direct-docking probe card。

年度	重要發展記事
104 年度	推出高速、高功率IC Burn-in Board客製化專板。 取得ISO-9001認證。 設置SMT Line 等生產設備，開發先進PCB及Substrate組裝製程技術。
105 年度	3 月購得竹北莊敬路段土地，12 月發包興建總部廠辦大樓。 推出 Probe Card+Substrate+Probe Head Total Solution。 簡易合併子公司-毓祥科技股份有限公司。 推出高階 FPGA 開發平台，以遠優於國外同性質產品品質與服務，成功切入國內 IC design house。
106 年度	導入飛針測試機台。 成功開發出超大 PCB 整合加工新製程技術(610mmx610mm)。 成功開發 77GHz 載板設計及量測技術。
107 年度	1 月莊敬北路新廠辦大樓完工，並陸續遷入。 4 月本公司股票補辦首次公開發行申報生效。 5 月本公司股票登錄興櫃買賣。
108 年度	1 月上櫃審議會通過本公司的上櫃申請案。 4 月上櫃掛牌買賣。
109 年度	3 月合併吸收 100%子公司銳萊科技股份有限公司。
112 年度	3 月轉投資成立 100%孫公司上海芯埕科技有限公司。
113 年度	3 月投資成立 100%美國子公司 KSMT USA CORPORATION。

二、風險事項

(一)風險因素

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1)利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

截至公開說明書刊印日止，本公司並無對外(包含金融機構及非金融機構)借款之情事，且本公司最近年度利息收入之金額，以及各該金額佔營業收入淨額之比例並不重大，故整體而言，利率變動對本公司損益並無重大影響。

(2)匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司外銷之應收帳款、採購部分原料、設備等採購係採外幣結算，加上外幣的銀行存款，因而易受匯率變動影響。本公司 111 年及 112 年度之兌換利益(損失)分別為 62,610 仟元及 (2,478)仟元，占各該年度營業收入淨額分別為 4.09%及(0.18%)；本公司將隨時注意匯率相關之國際金融資訊，並與金融機構保持密切聯繫，以充分掌握匯率變動趨勢，同時本公司將視匯率變動情形，適時調

整外匯持有部位，以降低匯率變動對損益造成之影響。

(3)通貨膨脹變動對公司損益之影響及未來因應措施：

根據行政院主計處公布之 112 年 1 月份發布最新消費者物價總指數(CPI，以 110 年為基期 100)，112 年全年我國 CPI 指數較 111 年上漲 2.50%；就主要國家物價變動，日本上漲 3.3%、新加坡上漲 4.8%、香港上漲 2.1%、中國大陸上漲 0.2%、南韓上漲 3.6%，美國上漲 4.1%。最近年度通貨膨脹情形，對本公司損益並無重大影響。未來本公司將持續密切觀察物價指數變化，視通貨膨脹對本公司的影響，適時反應產品售價以因應物價波動成本上揚之影響。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司專注於本業經營，財務操作以保守穩健為原則，並未從事高風險、高槓桿投資。本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」，相關作業程序業經股東會決議通過，作為本公司執行相關交易之依據。最近一年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人、為他人背書保證及從事衍生性商品交易之情事。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司的核心技術為測試板電路設計及線路佈局、對訊號及電力之匹配模擬等，自建各式之電路設計模組化，協助客戶解決在測試端所遇到的測試困難點，以現有機構及 PCB 電路板設計技術的基礎下發展，配合客戶的對電路設計困難度較高的 IC 晶片產品測試需求，補足現有測試設備及技術無法配合的瓶頸。

(1)未來研發計畫：

A.維持後段測試載板產業優勢：

因應未來高速數位傳輸與無線應用相關電子產品及工業 4.0 之蓬勃發展，發展高頻高速之測試載板平台與解決方案是本公司未來研發重點，為了持續維持競爭優勢及配合客戶需求，以下為研究發展重心：

- a. 0.32mm/0.35mm BGA pitch multi-DUT load board design
- b. 開發 BIB 高階平台轉低階平台測試，使兩平台可以共用
- c. 5G mmWave 28G/39G/55/60GHz probe card/multi-site OTA load board 全速 IC 測試介面載板
- d. 0.25mm/0.3mm/0.32mm BGA pitch multi-DUT load board IC 測試介面載板
- e. Non-skip die multi-DUT AP probe card/load board IC 測試介面載板
- f. 0.35mm BGA pitch multi-DUT, BIB for LC2 老化測試介面專板

B. 發展全速測試晶圓探針卡：

IC 功能整合度越來越高，多核心及高速介面、高密度排版等之產品，使得產品越變越複雜。IC 設計前的系統規畫及模擬測試分析，隨產品的複雜度

提高，就變得愈來愈重要，本公司計畫發展 5G mmWave 28G/39G/50GHz RF 量測技術與建立及提供完整模擬分析服務予客戶。以下為前段測試載板（晶圓探針卡測試載板）研究發展重心：

- a. PCIE Gen5 32Gbps/Serdes 112Gbps 全速測試晶圓探針卡
- b. 5G mmWave 28G/39G/50GHz MEMS probe card/load board design
- c. 3 奈米製程 high pin count (>60000) MEMS probe card/load board IC 測試介面載板
- d. 小於 45um pitch TV 晶片 MEMS 探針卡解決分案

C.將朝產品及技術垂直整合方向前進。

(2)預計投入研發費用：

本公司111年及112年度之研發費用占各年度營收比重分別為13%及12%，因全球半導體產業景氣下調，致研發投入金額從111年的196,300仟元減少到112年的166,118仟元，減少幅度15.38%。預計以後年度應會投入同樣水準的研發支出金額，以維持本公司競爭優勢。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司營運活動均遵循國內外現行相關法令規範，各相關業管人員亦隨時注意法令變動之情形，且提出即時資訊供公司管理階層參考，因而國內外重要政策及法律變動，本公司均能即時掌握並有效因應。從 108 年起中美貿易爭議的持續演變，全球所有半導體產業均產生不小的影響，本公司會隨時注意相關趨勢，適時調整營運架構。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無因國內外政策及法令變動而對財務與業務產生重大不利影響之情事。

5.科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司處於半導體測試產業鏈中，提供晶圓 IC 測試載板及服務等，本公司隨時注意相關產業之技術發展趨勢，在新技術發展初期，本公司即與客戶一同研發新的測試技術、電路布局規劃、開發新的測試板材、機構組件、貼合技術等，同時管理階層亦充分掌握未來市場方向並適時調整技術開發策略，以降低科技或產業變化對本公司造成之影響。最近年度及截至年報刊印日止，科技改變、資通安全風險及產業之變化對本公司財務及業務並未有重大之影響。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來一直致力維護公司形象，並秉持誠信、穩健之經營理念從事商業活動，且未來正朝向強化公司治理方面前進。最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無因企業形象改變而對公司產生重大影響之情事。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司目前無任何併購計畫。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司 107 年 1 月以前之營業登記場係為租賃場所。鑒於公司永續發展及因應營收規模擴大而產生自建廠房的需求，故於 105 年 2 月向新竹縣政府標得工業地一筆(竹北莊敬段 725 號，基地面積: 1449.98m²)，並於同年 12 月開始興建總部廠辦大樓(地上 5 層、地下 3 層、總樓板面積：6126.88m²)，已於 107 年 2 月陸續遷入新廠址開始營運。

基於公司長期營運所需及擴充產能需要，董事會於 113 年 3 月 15 日通過購置新土地及廠房案，預計交易總金額 433,750 仟元，取得土地面積 1,511.83 平方公尺(折合約 457.33 坪)及建物面積 6,197.52 平方公尺(折合約 1,874.93 坪)。預期公司將整合各分散辦公室人員，使整體營運管理溝通將更有效率，除直接節省租金支出及增加同仁的凝聚力與向心力外，公司也會取得較大生產空間，有利於未來新產品線的產能規劃，使擴充廠房產生之風險降到最低。

隨著營收及員工人數成長現有廠辦已經飽和不敷使用，且租用其他辦公室因應人力的增加。因此基於公司長期營運所需及擴充產能，本公司於 113 年 3 月度董事會通過總價 433,750,仟元，取得新竹縣竹北市泰和段土地及廠房。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨集中所面臨之風險及因應措施：

半導體測試載板主要原料為印刷電路板(PCB, Print Circuit Board)、金屬框架(Stiffenr)、繼電器(Relay)、線材等材料，這些進貨原料本公司均有超過兩家以上的供應商，依據市場供貨狀態及客戶季節性訂單需求等，透過詢比議價及交期需求調整其進貨比例。對於原料供應商的選擇，係以產品之品質、可靠度、穩定度及安全性為考量，以符合客戶要求。而本公司對原料及其供應商訂定相關審核及管理辦法，因此在品質及供貨條件皆可符合本公司需求。以此管理模式及運作可確保穩定供貨，加上主要原料都已開發二家以上合格供應商，因此應可有效降低原料進貨來源過度集中風險。故截至目前為止供貨情況良好，並未有供貨短缺或中斷以致影響本公司業務之情事。

(2)銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司 112 年占 10%總銷貨百分比以上的客戶有一家，本公司的主要客戶為台灣及亞洲地區的 IC 測試產業及 IC 設計客戶。未來重心將持續投入研發資源，開發新產品及提供新的測試解決方案服務，並與產業界中重要的測試零組件探測頭、探測針、Substrate 供應商策略合作，提供多元的產品線組合和服務提供客戶選擇。除維持已有良好合作的既有客戶外，也積極拓展海外新客戶，以避免過度集中單一市場或客戶所造成的潛在風險。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉或更換之情形。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉或更換之情形而對公司本公司之經營營運產生風險。

12.其他重要風險及因應措施：無。

(二)訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

無。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響

無此情形。

(四)其他重要事項

有關本公司針對關鍵技術的掌握暨營業秘密保護之具體措施，係透過執行本公司內部控制制度程序來達成目標，避免本公司關鍵技術文件及重要機密資料外流，以下分別依照文件及資料的控管、人員接觸權限之控管及網路系統及程式等控管三個層面說明：

1. 文件及資料的控管：

- A. 依本公司「電腦化資訊系統管制制度」中的「檔案及設備安全控制作業」中規定，公司機密資料或檔案應予以做權限控管或是加密保護，避免公司內部無相關權限之人可以取得機密資料。
- B. 依本公司「研發循環」中的「研發技術及文件保管」中規定，本公司各階段產出之技術工程文件列為機密文件，由專案負責人負責相關文件變更之管理；專案量產後對於文件之變更，依「文件及資料管理辦法」規定執行。機密文件之控管及後續變更程序，均須經權責主管核准方可進行

2. 人員接觸權限之控管：

- A. 依本公司「電腦化資訊系統管制制度」中的「資通安全檢查控制作業」中規定，資訊單位人員對因職務或業務而知悉或持有本公司科技與業務機密應負有保密義務。
- B. 依本公司「電腦化資訊系統管制制度」中的「資通安全檢查控制作業」中規

定，對於公司外部人員，例如委外人員之電腦通行使用權利應經適當控管，委外期間結束後，應立即收回該項權利。

3. 網路系統及程式之控管：

- A. 依本公司「電腦化資訊系統管理制度」中的「資通安全檢查控制作業」中規定，本公司應於資訊系統設置防火牆及防毒軟體等相關安全設定，以防止駭客或電腦病毒之侵害。本公司資訊人員亦定期檢視防火牆運作情形。
- B. 依本公司「電腦化資訊系統管理制度」中的「資通安全檢查控制作業」中規定，委外作業應簽訂契約，並於契約內容規範須符合公司資訊安全政策及法律要求。
- C. 本公司有網路資安監控相關軟體，針對公司重要資料或是研發資料庫之所有異動及存取有相關的紀錄，可以追蹤控管。

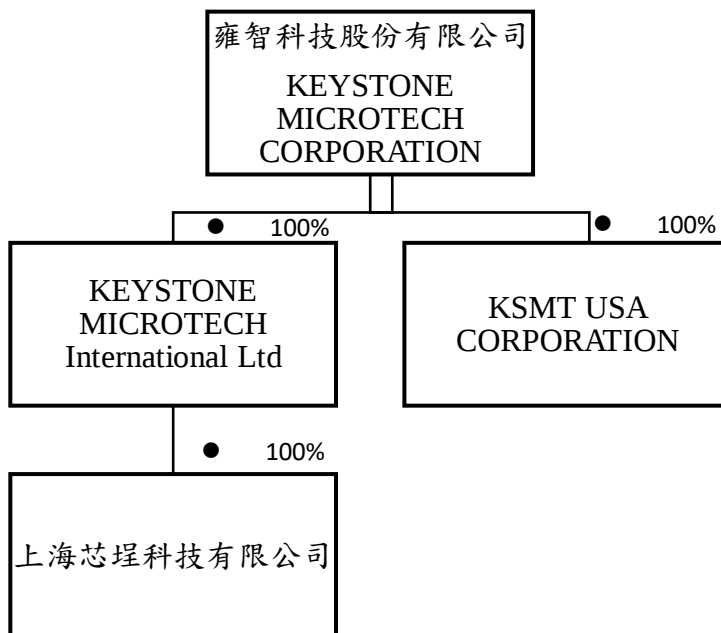
透過上述文件及資料的控管、人員接觸權限之控管及網路系統及程式之控管等程序，落實並執行本公司內部控制制度的相關規定，避免本公司關鍵技術暨營業秘密的機密資料或文件遭竊取或外流，以保護本公司之重要資產及維持競爭力。

本公司聘僱契約第五條亦明訂保密義務相關規範，在員工於雙方僱傭關係結束後，仍負有保護營業秘密之義務，離職員工對於因職務之需要而知悉或持有本公司之營業秘密，非經本公司事前書面同意，離職員工不得以口頭、影印、借閱、交付、文章發表或以其他任何方法，洩露於合作廠商、競爭者或其它第三人以及本公司業務不相關之員工。

三、公司組織

(一) 關係企業圖

1.關係企業圖：



2.各關係企業基本資料：

112 年 12 月 31 日；單位：元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
KEYSTONE MICROTECH International Ltd	112/3/23	Portcullis Chambers, P.O. Box 1225, Apia, Samoa	USD \$600,000	一般投資業務
上海芯埕科技有限公司	112/3/24	上海市嘉定區菊園新區環城路 2222 號 1 幢 JT8471 室	RMB \$4,054,126	半導體測試零組件銷售及提供技術諮詢和技術服務
KSMT USA CORPORATION	113/03/08	28 N FIRST ST 900 SAN JOSE, CA 95113	USD \$1,000,000	提供客戶半導體測試技術諮詢及市場行銷

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

企業名稱	主要營業項目	往來分工情形
KEYSTONE MICROTECH International Ltd	一般投資業務	不適用
上海芯埕科技有限公司	半導體測試零組件銷售及提供技術諮詢和技術服務	半導體測試零組件銷售及提供技術諮詢和技術服務
KSMT USA CORPORATION	提供客戶半導體測試技術諮詢及市場行銷	提供客戶半導體測試技術諮詢及市場行銷

(二)董事資料

1.董事資料：

113 年 02 月 29 日；單位：股

職稱	姓名	性別	年齡	國籍或 註冊地	初次 選任 日期	選(就)任 日期	任期	選(就)任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人			備 註
								股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			職稱	姓名	關係	
董事長 (註1)	李職民	男	59	中華民國	95/9/6	110/8/2	3 年	599,073	2.43%	599,073	2.20%	935,961	3.44%	3,097,490	11.44%	國立台灣大學電機系碩士 瑞昱半導體(股)公司行銷副總經理	本公司總經理 寬逸投資有限公司 董事長	-	-	-	註 2
董事	寬逸投資 有限公司	-		中華民國	106/6/8	110/8/2	3 年	3,097,490	12.58%	3,097,490	11.38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	法人董事 代表人- 李明義	男	62	中華民國	107/9/28	110/8/2	3 年	172,581	0.70%	60,581	0.22%	24,000	0.09%	-	-	Newport University MBA 邁特電子總經理特別助理 亞帝歐光電董事長特別助理 振曜科技總經理特別助理 友勁科技製造部協理 全友電腦維修組長/採購工程師	本公司協理	-	-	-	
董事	盧俊郎	男	51	中華民國	99/5/17	110/8/2	3 年	362,464	1.47%	362,464	1.33%	292,500	1.07%	-	-	國立中山大學電機系碩士 中華電信研究所	本公司技術長	-	-	-	
董事	葉啟鴻	男	66	中華民國	95/9/6	110/8/2	3 年	685,146	2.78%	290,146	1.07%	3,000	0.01%	-	-	台灣科技大學電機系 聯華電子測試部協理 碩邦科技測試處長	吉比鮮釀副董事長	-	-	-	
獨立 董事	林江亮	男	52	中華民國	107/9/28	110/8/2	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學會計學系學士/碩士/ 博士 中原大學總務處總務長 中原大學非營利研究主任 中原大學會計學系主任 中原大學會計學系教授 美詒國際(股)公司獨立董事	東訊(股)公司獨立 董事 瑞耘科技(股)公司 獨立董事 精拓科公司獨立董 事	-	-	-	
獨立 董事	陳啟文	男	58	中華民國	107/9/28	110/8/2	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立成功大學電機工程學碩博士 明新科技大學電子系所教授、主任 台灣半導體產業協會產學合作推 動小組召集人 台灣嵌入式單晶片協會理監事會 理事	-	-	-		
獨立 董事	陳金漢	男	58	中華民國	110/8/2	110/8/2	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學法律系 漢昇法律事務所執業律師	漢昇法律事務所執 業律師 華盈電子股份有限 公司獨立董事	-	-	-	

註1：原董事長李職民兼任總經理，李職民於112年10月2日卸任總經理，於同日劉安炫接任總經理。

註2：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人說明其原因、合理性、必要性及因應措施:本公司原董事長兼任總經理係為了提升經營效率與執行力，但原董事長李職民兼任總經理已於112年10月2日起卸任總經理，改由日劉安炫接任總經理。故目前已無董事長兼任總經理之情形。

2.法人股東之主要股東：

113 年 02 月 29 日

法 人 股 東 名 稱 (註 1)	法 人 股 東 之 主 要 股 東
寬逸投資有限公司	陳綺敏(96.15%)；李職民(3.85%)

3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：不適用。

4.董事或監察人所具專業知識及獨立性之情形：

本公司現任董事會成員之獨立性及專業背景多元化政策落實情形如下：

姓名	職稱	性別	主要現職	兼任其他公開發行人公司獨立董家數	獨董任期年資			專業知識與技能			年齡	
					3 年以下	3~9 年	9 年以上	產業知識	財務會計	法律/經濟	50~60 歲	60~70 歲
李職民	董事長	男	雍智科技董事長					V			V	
李明義	法人董事之代表人	男	雍智科技協理					V			V	V
盧俊郎	董事	男	雍智科技技術長					V			V	
葉啟鴻	董事	男	吉比鮮釀副董事長					V				V
林江亮	獨立董事	男	東訊（股）公司獨立董事 瑞耘科技（股）公司獨立董事 董事精拓科公司獨立董事	3		V			V		V	
陳啟文	獨立董事		明新科技大學電子系所教授			V		V			V	
陳金漢	獨立董事	男	漢昇法律事務所執業律師 華盈電子股份有限公司獨立董事	1	V					V	V	

5. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」訂定董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- (1)營運判斷能力。
- (2)會計及財務分析能力。
- (3)經營管理能力。
- (4)危機處理能力。
- (5)產業知識。
- (6)國際市場觀。
- (7)領導能力。
- (8)決策能力。

本公司現任董事分別具備經營管理、研發、財務會計、法律及半導體等之專業背景及產業經歷，符合多元化之重要項目。

獨立董事任期目前有二位為第二任期，一位為第一任期。

(2) 董事會性別平等：

目前董事會為男性成員尚未達成多元性別平等目標。

(3) 董事會獨立性：

本公司現任董事七席，其中獨立董事三席，獨立董事佔所有董事成員比率43%。董事採候選人提名制選任，並於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，本公司董事間並無具有配偶或二親等以內之親屬關係情形，獨立董事於執行業務範圍內保持其獨立性，最近2年並無提供本公司商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額，並無與公司有直接或間接之利害關係。

四、資本及股份

(一)股本形成經過

1.公司最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動之情形。

113 年 03 月 25 日；單位：股；新台幣元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外之 財產抵充股款 者	其 他
95/09	10	7,500,000	75,000,000	6,350,000	63,500,000	設立股本	無	註 1
99/05	10	7,500,000	75,000,000	7,400,000	74,000,000	現金增資 10,500,000 元	無	註 2
99/11	10	10,000,000	100,000,000	8,140,000	81,400,000	盈餘轉增資 7,400,000 元	無	註 3
100/11	10	10,000,000	100,000,000	9,930,800	99,308,000	盈餘轉增資 17,908,000 元	無	註 4
101/11	10	15,000,000	150,000,000	10,896,080	108,960,800	盈餘轉增資 9,652,800 元	無	註 5
102/09	10	15,000,000	150,000,000	11,960,888	119,608,880	盈餘轉增資 10,648,080 元	無	註 6
103/12	10	20,000,000	200,000,000	16,691,642	166,916,420	盈餘轉增資 47,307,540 元	無	註 7
104/10	10	20,000,000	200,000,000	19,175,290	191,752,900	盈餘轉增資 24,836,480 元	無	註 8
105/10	10	36,000,000	360,000,000	21,079,419	210,794,190	盈餘轉增資 19,041,290 元	無	註 9
106/02	10	36,000,000	360,000,000	21,022,419	210,224,190	庫藏股註銷 570,000 元	無	註 10
106/08	10	36,000,000	360,000,000	23,124,661	231,246,610	盈餘轉增資 21,022,420 元	無	註 11
106/12	36	36,000,000	360,000,000	24,624,661	246,246,610	員工認股權憑證 換發新股 15,000,000 元	無	註 12
108/04	75	36,000,000	360,000,000	27,075,661	270,756,610	初次上櫃現金增 資 24,510,000 元	無	註 13
111/08	0	36,000,000	360,000,000	27,225,661	272,256,610	發行無償限制型 員工權利新股 150,000 股	無	註 14
112/08	0	36,000,000	360,000,000	27,217,661	272,176,610	註銷限制型員工 新股 8,000 股	無	註 15

註 1：95 年 09 月 11 日經授中字第 09532818990 號函核准在案。
 註 2：99 年 05 月 21 日經授中字第 09932073310 號函核准在案。
 註 3：99 年 11 月 08 日經授中字第 09932799690 號函核准在案。
 註 4：100 年 11 月 08 日經授中字第 09932799690 號函核准在案。
 註 5：101 年 11 月 29 日經授中字第 10132775110 號函核准在案。
 註 6：102 年 09 月 10 日經授中字第 10233875430 號函核准在案。
 註 7：103 年 12 月 09 日經授中字第 10333949790 號函核准在案。
 註 8：104 年 10 月 07 日經授中字第 10433803390 號函核准在案。
 註 9：105 年 10 月 27 日經授中字第 10534404210 號函核准在案。
 註 10：106 年 02 月 20 日經授中字第 10633094020 號函核准在案。
 註 11：106 年 08 月 18 日經授中字第 10633490130 號函核准在案。
 註 12：106 年 12 月 12 日經授中字第 10633736750 號函核准在案。
 註 13：108 年 04 月 26 日經授中字第 10833254250 號函核准在案。
 註 14：111 年 08 月 10 日經授中字第 11133490060 號函核准在案。
 註 15：112 年 08 月 17 日經授中字第 11233499020 號函核准在案。

2.最近三年度及截至公開說明書刊印日止，私募普通股之辦理情形：無。

(二)最近股權分散情形

1.主要股東名單：

持股比例達百分之五以上之股東或持股比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例：

112年04月28日；單位：股；%

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
寬逸投資有限公司	3,097,490	11.38
陳綺敏	935,961	3.44
花旗託管波露寧新興市場基金公司專戶	647,654	2.38
李職民	599,073	2.20
慧榮投資股份有限公司	577,717	2.12
富邦人壽保險股份有限公司	472,000	1.73
葉啟鴻	455,146	1.67
李哲宇	369,284	1.36
盧俊郎	362,464	1.33
揚積國際科技股份有限公司	349,273	1.28

2.最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十以上股東放棄現金增資認股之情形：無此情形。

(三)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元；仟股

項目 \ 年 度		111 年	112 年	當年度截至 113 年 3 月 21 日
每股市價 (註1)	最 高	331	331.5	319.5
	最 低	142	180.5	261.5
	平 均	217.74	214.00	293.10
每股淨值 (註2)	分 配 前	75.71	81.66	-
	分 配 後	68.21	75.11	-
每股盈餘	加權平均股數	27,076	27,218	-
	每 股 盈 餘	15.01	13.07	-
每股股利	現 金 股 利	7.5	6.55	-
	無 償	-	-	-
	配股 - 盈餘配股	-	-	-
	配股 - 資本公積配股	-	-	-
累積未付股利		-	-	-
投資報酬分析	本益比 (註1)	14.51	16.37	-
	本利比 (註2)	29.03	32.67	-
	現金股利殖利率 (註3)	3.44%	3.06%	-

註 1：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 2：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 3：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價

(四)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，依法應先提繳稅款，彌補以往年度虧損後，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累計已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後分派之。

本公司董事會得經三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

另依據本公司章程規定，本公司股利政策，須視公司目前及未來之投資環境、未來投資計畫、財務結構及營運情形，並兼顧股東利益等因素，本公司每年至少就當年度餘額（不含累積未分配盈餘）提撥不低於 20%作為股利分派，惟如當年度餘額（不含累積未分配盈餘）低於實收股本百分之十時，得不予分配；股利政策得以股票或現金之方式分派之，惟現金股利分派之比例以不低於當年度發放股利總額 10%。

法定盈餘公積累計已達公司實收資本額時，得不再提列。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

上述股利政策經 112 年股東常會決議通過後實施。

2.以前年度股東股利分配之情形：

本公司 111 年度之盈餘分配案業於 112 年 06 月 26 日股東會決議通過：

	盈餘分配案	每股股利（元）
法定盈餘公積	\$40,645,040	-
現金股利	\$204,192,458	\$7.5
股票股利	-	-

上述 111 年度之盈餘分配案並經本公司董事會 112 年 08 月 07 日董事會決議，除息基準日及相關日期如下：

- (1) 除息交易日：112 年 08 月 22 日。
- (2) 除息基準日：112 年 08 月 28 日。
- (3) 股票最後過戶日：112 年 08 月 23 日。
- (4) 股票停止過戶期間：自 112 年 08 月 24 日起至 112 年 08 月 28 日止。
- (5) 現金股利發放日：112 年 09 月 06 日。

3.本年度已擬議股東股利分配之情形：

本公司 113 年 03 月 04 日董事會擬議 112 年度盈餘分配案如下：

	盈餘分配案	每股股利（元）
法定盈餘公積	\$35,420,248	-
特別盈餘公積	\$216,421	
現金股利	\$178,275,680	\$6.55

有關 112 年度之盈餘分配案預計於 113 年 06 月 03 日召開之股東會決議通過。

4.預期股利政策將是否有重大變動:無此情形。

(五)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本年度無擬議股票股利，故不適用。

(六)員工、及董事酬勞

1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應以不低於當年度獲利狀況之 10%分派員工酬勞及應以不高當年度獲利狀況之 1%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞發放之方式得以股票或現金為之，發放之方式、數額及股數應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞發放對象係以受聘或受雇於本公司從事工作，並經正式任用且享有勞工保險待遇之從業人員為限，並包含符合一定條件之從屬員工，而不包含臨時、試用人員。

董事(含獨立董事)酬勞發放之方式以現金為之，授權董事會於上限範圍內，以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

年度終了後，本合併財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，本合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案業經 112 年 03 月 06 日董事會決議通過，配發董事酬勞 1,400 仟元、員工酬勞 60,105 仟元，與認列年度之估列金額相同。

本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案業經 113 年 03 月 04 日董事會決議通過，配發董事酬勞 1,700 仟元、員工酬勞 52,500 仟元，與認列年度之估列金額相同。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未配發員工股票酬勞，故不適用。

4.股東會報告分派酬勞情形及結果：

(1)股東會決議配發員工現金酬勞、股票酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與董事會擬議分配金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案業經 112 年 03 月 06 日董

事會決議通過，配發董事酬勞 1,400 仟元與員工酬勞 60,105 仟元，提交 111 年 06 月 27 日本年度股東常會報告。

本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案業經 113 年 03 月 04 日董事會決議通過，配發董事酬勞 1,700 仟元與員工酬勞 52,500 仟元，擬提交 113 年 06 月 03 日本年度股東常會報告。

(2)股東會決議配發員工股票酬勞者，所配發股數及其占盈餘轉增資之比例：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未配發員工股票酬勞。

(3)考慮擬議配發員工、董事及監察人酬勞後之設算每股盈餘：

本公司 111 及 112 年度員工酬勞皆以現金發放，加以員工及董事酬勞皆已費用化，故對每股盈餘並無影響。

5.前一年度員工及董事人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、與其認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 112 年 03 月 06 日董事會決議配發 111 年度員工及董事酬勞如下，並已提 112 年 06 月 26 日股東常會報告，與認列年度之估列金額相同，實際配發情形並無差異情形：

單位：新台幣仟元			
項 目	董事會通過數	實際配發數	差異
員工酬勞-現金	60,105	60,105	—
員工酬勞-股票	—	—	—
董事酬勞	1,400	1,400	—

6.員工、董事酬勞給付酬金之政策、酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性及執行情形：

公司章程規定，應以不低於當年度獲利狀況之 10%分派員工酬勞；及應以不高當年度獲利狀況之 1%為董監酬勞。依據 112 年度的財務報告，112 年度營業額為新台幣 1,410,225 仟元，較前一年減少 7.78%；稅後淨利新台幣 354,202 仟元，較前一年減少 12.85%；稅後基本每股盈餘由去年的 15.01 元減少至 13.07 元，較前一年減少 12.92%，112 年的經營績效較 111 年下滑。112 年度董事、員工酬勞分配案業經 113 年 03 月 04 日薪酬委員會及董事會參考 112 年的營運績效和公司章程規定，決議通過，配發董事酬勞 1,700 仟元(+21.42%，平均每位董事增加 4.29 萬)、員工酬勞 52,500 仟元(-12.65%)。並提交 113 年 06 月 03 日本年度股東常會報告。

單位：仟元			
年度	項 目	董事會通過數	增減比率%
112 年度	員工酬勞-現金	52,500	-12.65%
	董事酬勞	1,700	21.42%
	合計	<u>54,200</u>	-11.88%
111 年度	員工酬勞-現金	60,105	無
	董事酬勞	1,400	無
	合計	<u>61,505</u>	無

綜上所述，本公司支付董事、總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性。

貳、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1.業務範圍：

(1)公司所營業務之主要內容：

E603050	自動控制設備工程業
E605010	電腦設備安裝業
F113050	電腦及事務性機器設備批發業
F118010	資訊軟體批發業
F119010	電子材料批發業
F199990	其他批發業
F213030	電腦及事務性機器設備零售業
F218010	資訊軟體零售業
F219010	電子材料零售業
F299990	其他零售業
F401010	國際貿易業
I199990	其他顧問服務業
I301010	資訊軟體服務業
I301020	資料處理服務業
I301030	電子資訊供應服務業
I501010	產品設計業
I599990	其他設計業
ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2)主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元

主要產品	111 年度營收 金額	111 年度營收 比率(%)	112 年度營收 金額	112 年度營收 比率(%)
半導體晶圓測試-後段測試載板	1,102,387	72.09	1,152,957	81.76
半導體晶圓測試-前段測試載板	404,980	26.48	229,161	16.25
其他	21,867	1.43	28,107	1.99
合計	1,529,234	100.00	1,410,225	100.00

(3)公司目前之商品(服務)項目：

本公司提供之產品與服務在半導體供應鏈中屬於 IC 測試產業一環，在 IC 產業中扮演不可或缺的角色。本公司所提供產品及服務主要為製造及銷售半導體晶圓測試之各種測試載板，包含前段測試載板（晶圓探針卡測試載板）、後段測試載板（IC 測試載板及 IC 老化測試載板）及其他相關測試載板等項目，如

測試載板所需搭配 IC Socket、Probe Head、IC Burn-in Board 測試、IC 測試實驗室環境等，都是我們可以提供的產品與服務。我們長期與客戶一起發展，累積深厚的測試整合技術和經驗，能提供客戶兼具成本效率與完整可靠的測試解決方案。

(4)計畫開發之新產品：

- PCIE Gen5 32Gbps/Serdes 112Gbps 全速測試晶圓探針卡
- 5G mmWave 28G/39G/55/60GHz probe card/multi-site OTA load board 全速 IC 測試介面載板
- 3 奈米製程 high pin count (>60000) MEMS probe card/load board IC 測試介面載板
- 小於 45um pitch TV 晶片 MEMS 探針卡解決方案
- 0.25mm/0.3mm/0.32mm BGA pitch multi-DUT load board IC 測試介面載板
- Non-skip die multi-DUT AP Probe Card/Load Board IC 測試介面載板
- Multi-site hybrid MEMS Probe Card/Load Board IC 測試介面載板
- 0.35mm BGA pitch multi-DUT, BIB for LC2 老化測試介面專板

2.產業概況：

(1)產業現況與發展

(1)產業現況與發展

根據台灣半導體協會(TSIA)的資料統計，2023 年全球半導體市場全年總銷售值達 5,268 億美元，較 2022 年衰退 8.2%。

2023 年美國半導體市場總銷售值達 1,337 億美元，較 2022 年衰退 5.3%；日本半導體市場銷售值達 467 億美元，較 2022 年衰退 3.1%；歐洲半導體市場銷售值達 560 億美元，較 2022 年成長 4.0%；中國大陸市場銷售值達 1,551 億美元，較 2022 年衰退 14.0%；亞太地區半導體市場銷售值達 1,353 億美元，較 2022 年衰退 10.1%。

工研院產科國際所預估 2023 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 43,428 億元，較 2022 年衰退 10.2%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 10,965 億元，較 2022 年衰退 11.0%；IC 製造業為新臺幣 26,626 億元，較 2022 年衰退 8.8%，其中晶圓代工為新臺幣 24,925 億元，較 2022 年衰退 7.2%，記憶體與其他製造為新臺幣 1,701 億元，較 2022 年衰退 27.8%；IC 封裝業為新臺幣 3,931 億元，較 2022 年衰退 15.6%；IC 測試業為新臺幣 1,906 億元，較 2022 年衰退 12.8%。

2023 年延續了自 2022 下半年的高通膨、終端市場需求低迷、供應鏈持續調節庫存，整體市場預估仍將受制於供過於求和價格疲軟的問題。世界半導體貿易統計協會(WSTS)預估，

2024 年因生成式 AI 的普及推動相關半導體產品需求激增，加上記憶體需求預料大幅復甦下，全球半導體營收將達 5,883.64 億美元，年增 13.1%。記憶體晶片將引領 2024 年全球半導體市場成長，銷售額將較 2023 年躍增 44.8%；邏輯晶片市場預料成長 9.6%，影像感測器晶片市場預估增加 1.7%。

台灣半導體產業協會(TSIA)統計，2023 年台灣 IC 產業產值約 4.34 兆元、年減 10.2%，衰退幅度高於全球半導體市場的 8.2%。半導體業經過 2023 年庫存調

整後，2024 年在人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)等帶動下，料恢復強勁的成長動能，TSIA 委由工研院產科國際所調查，預估 2024 年台灣 IC 產業產值約將達 5 兆 116 億元，年增 15.4%，可望創下歷史新高，超越全球半導體業的年增 13.1%。

2024 年台灣 IC 設計業產值估達 1 兆 2570 億元，年增 14.6%；IC 製造業估達 3 兆 1038 億元，年增 16.6%，其中，晶圓代工產值估 2 兆 9060 億元，年增 16.6%；記憶體與其他產值達 1978 億元，年增 16.3%；IC 封裝業 4362 億元，年增 11%；IC 測試業估 2146 億元，年增 12.6%。

2023 年台灣 IC 產業產值統計結果

億新台幣	23Q1	季成長	年成長	23Q2	季成長	年成長	23Q3	季成長	年成長	23Q4	季成長	年成長	2023	年成長
IC 產業產值	10,084	-15.8%	-13.0%	10,150	0.7%	-18.0%	11,161	10.0%	-10.2%	12,033	7.8%	0.5%	43,428	-10.2%
IC 設計業	2,400	-7.7%	-27.3%	2,685	11.9%	-22.2%	2,880	7.3%	-3.0%	3,000	4.2%	15.4%	10,965	-11.0%
IC 製造業	6,279	-18.4%	-5.8%	6,075	-3.2%	-15.6%	6,756	11.2%	-11.6%	7,516	11.2%	-2.4%	26,626	-8.8%
晶圓代工	5,873	-18.8%	-1.6%	5,647	-3.8%	-13.3%	6,316	11.8%	-11.4%	7,089	12.2%	-2.0%	24,925	-7.2%
記憶體與其他製造	406	-12.7%	-41.8%	428	5.4%	-37.3%	440	2.8%	-13.7%	427	-3.0%	-8.2%	1,701	-27.8%
IC 封裝業	940	-17.5%	-14.5%	927	-1.4%	-19.4%	1,035	11.7%	-18.5%	1,029	-0.6%	-9.7%	3,931	-15.6%
IC 測試業	465	-12.6%	-11.4%	463	-0.4%	-19.5%	490	5.8%	-11.7%	488	-0.4%	-8.3%	1,906	-12.8%
IC 產品產值	2,806	-8.5%	-29.8%	3,113	10.9%	-24.7%	3,320	6.6%	-4.6%	3,427	3.2%	11.8%	12,666	-13.7%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,268	-8.2%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所(2024/02)

台灣半導體產業累積多年的研發技術及投入資金的投入，有堅強且完整的產業鏈，因而在全球半導體產業占有舉足輕重的角色，IC 設計、晶圓代工、IC 封裝及測試等，也都名列全球前幾大供應商，台灣因此成為全球半導體產業的目光焦點。未來 5G 普及化、車聯網、物聯網、VR/AR、人工智慧 AI、(IOT)平台架構、智慧家庭/城市、智慧遠端照護及醫療、智慧工廠(工業 4.0)等新世代的應用發展，估計全球半導體產業的產值仍會持續成長。台灣 IC 產業的產值因為有堅強技術和完整的產業鏈，今年來台灣半導體廠接單暢旺，產能持續供不應求，包括 5G 及高效能運算 (HPC) 相關晶圓代工及封測接單暢旺，新冠肺炎疫情加快數位轉型，帶動筆電及平板、伺服器、網通裝置、遊戲機等晶片需求。業界預期產能吃緊將延續到下半年，晶圓代工及封測代工價格看漲，記憶體因供不應求，價格已出現明顯漲幅。

2020 ~ 2024 年台灣 IC 產業產值

億新臺幣	2020	2020 成長率	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024(e)	2024(e) 成長率
IC 產業產值	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	50,116	15.4%
IC 設計業	8,529	23.1%	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,570	14.6%
IC 製造業	18,203	23.7%	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	31,038	16.6%
晶圓代工	16,297	2.1%	19,410	19.1%	26,847	38.3%	24,925	-7.2%	29,060	16.6%
記憶體與其他製造	1,906	19.4%	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,978	16.3%
IC 封裝業	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,362	11.0%
IC 測試業	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,146	12.6%
IC 產品產值	10,435	22.4%	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-10.2%	14,548	14.9%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	4,404	6.8%	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,268	-8.2%	5,958	13.1%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2024/02)

說明：

註：(e)表示預估值(estimate)。

(1) IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業。

(2) IC 產品產值=IC 設計業+記憶體與其他製造。

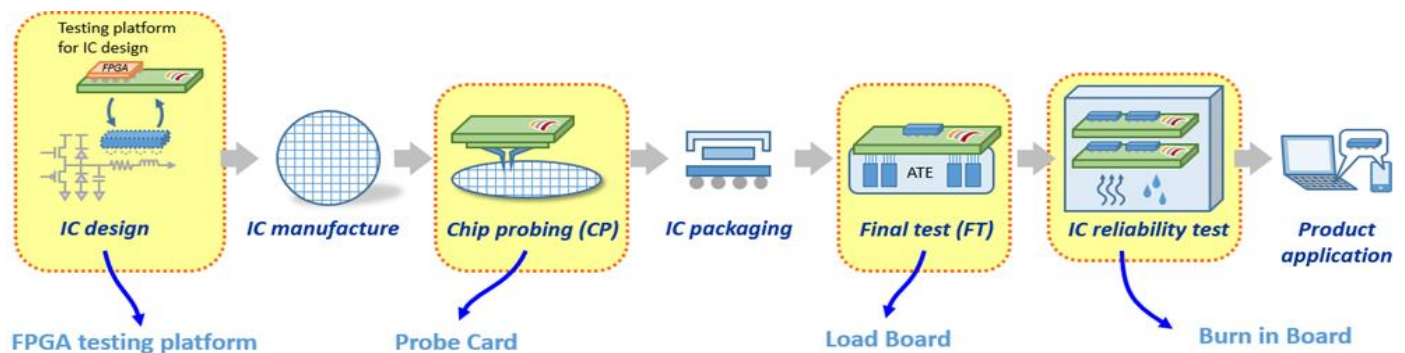
(3) IC 製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造。

(4)上述產值計算是以總部設立在台灣的公司為基準。

(2)半導體測試產業與產業上、中、下游之關聯性：

在半導體製程中，測試產業扮演重要的角色，尤其對於製程良率、品質良窳、成本控管，測試的時程要求與效率，都需要測試產業提供測試機台、測試設備、專業驗證服務及各項測試的零組件，替各階段 IC 產品的生產流程品質把關。

下圖為測試產業在 IC 半導體的生產流程中，對每一階段所提供的測試服務流程圖：



本公司累積長久的測試服務整合能力，致力提供半導體測試最佳化的整合解決方案，舉凡前端的 IC 設計(FPGA IC 設計模擬平台)、IC 晶圓測試(Probe Card)，以及後段的 IC 老化測試(Burn in Board)及 IC 封裝測試(Loard Board；Final Test (FT))等，雍智能設計、製造並整合客戶測試的需求，同時提供兼具測試效率與成本的最佳解決方案。

(3) 本公司提供之營業務主要內容：

本公司主要從事半導體測試介面產品之研發、生產與銷售，主要產品包括前段測試載板（晶圓探針卡測試載板(Probe Card)）、後段測試載板（IC 測試載板(Load Board)及 IC 老化測試載板(Burn-in Board)）及其他相關測試載板和服務：

A. 前段測試載板:晶圓探針卡(Probe Card)測試載板

本公司主要提供晶圓探針卡(Probe Card)當中之 PCB 測試載板的電路設計和製造為主。探針卡(Probe Card)是一片佈滿探針的 PCB 測試電路板，加上探測頭(Probe Head)、探測針(Probe Needles)、Substrate 載板等機構組成，用於機台和待測晶圓間測試分析的介面測試，檢驗製作完成後整片晶圓的良率，主係以探針卡上面的探針(Probe needles)對裸晶進行電性量測，篩選出瑕疵或故障的晶粒等不良品，降低不良品進入後段封裝製程，避免構裝成本的浪費。

B. 後段測試載板: IC 測試載板(Load Board)

IC 測試板是介於封裝之後的 IC 及測試機台之間的介面卡板，主要功能為承載封裝後之 IC 做為載體之用，IC 測試載板內部有線路連接封裝後之 IC 與測試機台，一般用於高階的封裝製程中。

C. 後段測試載板: IC 老化測試板(Burn in Board)

人工智慧 (AI) 時代來臨，物聯網、車用電子發展迅速，加上 5G 將成為主流規格，未來半導體產業將走向更市場導向、更創新的應用領域，尤其汽車市場逐步走向車聯網、電動車領域，需要更多駕駛資訊輔助整合系統，因安全性之考量，需仰賴 IC 高度可靠性運作，近年來因封裝技術提升，以多個 IC 置放至同一封裝體時，其整體壽命將會受到不同元件間的熱傳導相互干擾而下降，其產生的熱高達以往 IC 產品的數倍，因此溫度提高對 IC 壽命有一定程度的影響。老化板的設計及製作亦是 IC 測試的關鍵，由於半導體元件之應用頻率、速度、發熱、阻抗匹配等考量，在老化板的設計考量上相對複雜，隨著新興科技發展，愈來愈多之 IC 產品需經過老化測試。

(4)產品發展趨勢及競爭情形：

A.產品發展趨勢

伴隨著 IT 設備及裝置普及智慧手機等廣泛被使用，5G 高速傳輸技術的逐漸成熟、車聯網、物聯網、VR/AR、人工智慧 AI、(IOT)平台架構起智慧家庭/城市、智慧遠端照護及醫療、智慧工廠(工業 4.0)、及消費性行動裝置等新世代的應用發展，IC 晶片需要更強大運算能力、同時要求更小的體積、更低的電力消耗、更良好的通訊品質及更直覺的使用者介面操等，所執行這些功能的重要元件“IC”晶片就被賦予發展的核心重任。隨著 IC 製程技術精進朝向物理極限的微奈米化發展，才能製造出更微小輕薄、多疊構的 IC 封裝，以滿足這些推陳出新的應用發展，故未來半導體業將能繼續扮演各項產業火車頭的重要角色。

IC 產業一直朝向輕薄及微小化發展，近年 FOWLP(Fan-Out Wafer Level Package)技術逐漸取代傳統的 SiP(System in Package)技術，FOWLP 基本上就是將多個已知合格晶圓 KGD(Known Good Die)重構於晶圓載體上後，再經過晶圓及壓縮成型，能有效的縮減 IC 厚度及解決電源和訊號路徑過長等問題，讓產品更輕薄及效能更佳。但是 FOWLP 及 SiP 隨製程複雜化而單位價格逐漸升高，所以不論是 SiP 或 FOWLP 技術所生產的 IC 晶圓，都需要確保合格晶圓 KGD 的高良率，因為一個功能未盡完善的 Die 將造成整個 FOWLP 或 SiP 技術所生產的 IC 晶圓 Fail，形成生產成本和效率的重大損失。因此越來越多的客戶選擇在晶圓測試階段，不再僅有之前的晶圓 Probe card 的測試需求，而是逐漸要求能同時對 IC 功能作測試(Functional Test)，以確保之後執行先進製程封測時，可以獲得更高的良率，才能減少生產成本及提升品質。

因此如何在 IC 產品的 Wafer Level 階段執行功能測試(Functional Test)，挑選出功能正常及特性符合規格的 Die 就是一個重要課題。尤其當 IC 功能越來越強大，要求更快的速度及處理效能；對 IC 功能測試項目變多，造成在測試時，會產生高速及高頻所衍生的訊號干擾，因此 IC 測試載板(Load Board)及晶圓測試載板(Probe Card)也都要特別設計來因應，這發展趨勢將會對未來 IC 測試的一大挑戰，但是也是成長的機會。

一般 Load Board 需具備能完整測試 IC 功能的規格，而 Probe Card 僅測試 I/O 的 Open/Short，因此 Load Board 的電路設計較 Probe Card 相對複雜許多，而且 Load Board 也需要較多的 ATE(Auto Testing Equipment)相關知識搭配。

本公司長久於 Load Board 所累積的豐富經驗，讓我們站在相對有利的位置。我們會針對客戶需求，透過電路設計與線路佈局，以及對訊號及電力的匹配模擬，提供可靠及穩 PCBA+Substrate+Socket 或 PCBA+Substrate+Probe Head 等整體解決方案。讓客戶面對單一窗口快速有效解決問題，避免面對多個測試供應商，耗時耗力在溝通及釐清問題上。我們也積極規劃投入新的電路開發、佈局及模擬軟體，以強化我們 IC 設計能力。

除了新產品開發，本公司製程上不斷致力於新的組裝技術的改進，例如：添購高著裝準度的 SMT 機器、精密溫控 Reflow 及 3D 量測儀器等設備，以建構 Fine Pitch 之 Substrate+PCBA 之組裝技術。並規劃於新廠設立無塵室，開發新的製程技術以滿足未來客戶對更高階產品的測試技術和環境需求。

B.產品競爭情形

本公司產品及服務，主要在 IC 測試產業的電路圖模擬分析測試、IC 晶圓片測試的 Probe Card、產品老化及穩定性的 Burn-in board 載板及 IC 封裝後測試使用的 Load board 載板。需要與客戶在產品開發時就合作了解測試的需求及規格，無論在設計 IC 初期或是機台的測試階段，都需要隨時和客戶溝通和解決問題。本公司競爭者主要來自國內外。國內的競爭者，大部分為未上市櫃或是國外在台分公司，且規模較小；國內規模較大且為主要競爭者只有

一家上櫃大廠；國外的競爭者主要來中國大陸業者。為即時且有效率的服務大陸地區的 IC 設計廠及封測廠，本公司在上海設有據點，與大陸的其他提供類似測試版服務的廠商競爭。

隨著 IC 終端產品發展趨勢，IC 電路設計不斷微米化，具有技術能力，能提供兼具成本與效率的 IC 測試載板供應商會越來越少。本公司較其他競爭者具有優勢之處在於本公司擁有 10 年的測試載板設計經驗累積，自主或與客戶一起開發高速傳輸 77GHz 量產測試與驗證方案逐漸成熟，技術領先同業。此外，產品的布局完整，從 IC 設計的 FPGA、IC 晶圓片測試的 Probe Card、產品老化及穩定性的 Burn-in board 載板及 IC 封裝後測試使用的 Load board 載板，本公司都能提供一站式的產品和服務。本公司提供的測試產品品質穩定，且相對競爭對手良率高，加上相對眾多的 FAE 技術服務團隊能現場即時提供技術服務和測試問題的排除，與現有客戶保持穩定且長久的合作關係。對於新客戶而言，累積的經驗，更能全面提供在 IC 測試各個階段的技術服務及協助，以減低新產品量產的不利測試風險。

3.技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展：

因應未來高速數位傳輸與無線應用相關電子產品及工業 4.0 之蓬勃發展，發展高頻高速之測試載板平台與解決方案是本公司未來研發重點。本公司未來產品研發計畫如下：

- PCIE Gen5 32Gbps/Serdes 112Gbps 全速測試晶圓探針卡
- 5G mmWave 28G/39G/55/60GHz probe card/multi-site OTA load board 全速 IC 測試介面載板
- 3 奈米製程 high pin count (>60000) MEMS probe card/load board IC 測試介面載板
- 小於 45um pitch TV 晶片 MEMS 探針卡解決方案
- 0.25mm/0.3mm/0.32mm BGA pitch multi-DUT load board IC 測試介面載板
- Non-skip die multi-DUT AP probe card/load board IC 測試介面載板
- Multi-site hybrid MEMS probe card/load board IC 測試介面載板
- 0.35mm BGA pitch multi-DUT, BIB for LC2 老化測試介面專板

(2)研究發展人員與其學經歷

113 年 03 月 15 日

學歷分佈	人數(人)	比率	相關工作經驗 平均年資(年)
碩士/博士	30	25%	4.74
學士	85	70%	4.47
專科	6	5%	6.15
合計	121	100%	4.62

(3) 最近五年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

年度 項目	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
研發費用	122,739	174,722	183,392	196,300	166,118

(4)最近五年度開發成功之技術或產品：

年度	技術或產品名稱
108	Wise-ASIC 7 奈米製程 CP PCB + Substrate + Probe Head Direct-docking 晶圓探針卡 Multi-DUT PMIC 電源管理 IC 晶圓探針卡與其跨平台機構完整解決方案 AP 類 high-speed 以及 ASIC 類 100Watt 以上 HPB-5B, LC2 高階平台 BIB Design
109	5G mmWave 29GHz/39GHz RF Multi-DUT 晶圓探針卡與 AIM Load Board Design 5G 智能手機 AP、車用多媒體以及記憶體控制晶片三溫測試晶圓探針卡與 Load Board Design BIB RF 一系列 Project Design 功分器架構, 有 1 對 16 port(工作頻率 800MHz~6GHz), 1 對 8 port(工作頻率 850MHz~2.5GHz)
110	5G mmWave 29GHz/39/55GHz RF Multi-DUT 晶圓探針卡 4/5 奈米製程 5G 智能手機 AP、電視 ASIC 晶片、高速運算三溫測試晶圓探針卡與 Load Board IC 測試載板 BIB RF 一系列 Project Design 功分器架構:1 對 16 port(工作頻率 800MHz~6GHz), 1 對 8 port(工作頻率 850MHz~2.5GHz)
111	5G AP probe card with hybrid probe to handle high-speed and high-current testing PCIE Gen5 probe card with advanced MEMS probes to run at 32Gbps loopback testing Success in 3nm test chip probe card engineering test Success in GPU 600Amp & AI 300Amp load board and burn-in board
112	0.3mm pitch multi-site load board IC 測試介面載板開發完成 Wifi7 multi-site IC 測試介面載板開發完成 MEMS 探針混針式探針卡驗證完成 5G mmWave 55GHz multi-site 探針卡驗證完成 老化測試介面專板設計 mmWave 28GHz 功分器驗證完成 2000W AI GPU IC 老化測試介面專板驗證完成 適用於 mmWave 頻段自動化量測平台

4.長、短期業務發展計劃

(1)短期發展計畫：

A.以技術、品質及服務持續深耕客戶關係。

B.整合並發揮策略聯盟效益，以滿足客戶各種需求。

C.統合內部資源協助客戶即時解決問題。

D.培養國際行銷人才，拓展台灣成功經驗。

(2)中、長期發展計畫：

A.加強產品及技術垂直整合，期能以整體解決方案提供客戶。

B.持續開發策略聯盟夥伴並共創三贏。

C.參與國際組織並透過展覽及成果發表，以增加知名度有利於拓展海外市場。

(二)市場及產銷概況

1.市場分析：

(1)主要商品之銷售地區：

單位：新台幣仟元

年度 地區		111 年度		112 年度	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
外銷	亞洲	407,361	26.64%	643,890	45.66%
	其他	21,370	1.40%	13,832	0.98%
	小計	428,731	28.04%	657,722	46.64%
內銷		1,100,503	71.96%	752,503	53.36%
合計		1,529,234	100.00%	1,410,225	100.00%

(2)市場佔有率：

本公司所提供的產品與服務屬於測試產業供應鏈中的一環，有許多不同領域的測試供應商提供不同的服務，從測試設備機台、設計、零組件等。因提供 IC 測試的廠商眾多，且各具擅長的領域，故整體 IC 測試供應商的財務業務資訊有限，因此無法精確估算出本公司的市佔率。根據產業研究機構 TechInsights Inc 報告，2021 年雍智科技於全球 IC 測試產業 DIB (Device Interface Board) 名列全球第五。但此份統計無法提供完整的 DIB 整體市場詳細資訊，而且各家營收統計涵蓋其他測試產業的服務或產品，或其他非測試產業的產品，因此資料僅供參考。

Sales, \$M, Calendar Year

Rank	Company	Region	2018	2019	2020	2021
1	R&D Altanova	North America	48.00	49.00	54.50	60.50
2	Harbor Electronics	North America	42.00	49.00	57.00	53.23
3	TSE	Korea	27.12	28.97	32.45	46.34
4	Gorilla Circuits	North America	31.00	33.50	30.80	41.50
5	Keystone Microtech	Taiwan	21.40	26.68	28.80	31.45
6	Integrated Test Corporation	North America	27.50	28.70	25.70	30.00
7	Zero One	China	18.50	18.00	19.50	26.10
8	CMRSummit	North America	19.00	20.50	21.70	25.00
9	Synergie CAD	Europe	18.65	19.05	21.66	24.12
10	Chunghwa Precision Test	Taiwan	13.86	20.13	19.80	23.79
11	Sanmina	North America	19.60	20.50	21.00	22.52
12	Ace Tech Circuit	Korea	15.80	16.00	18.00	20.00
13	Hitachi High-Tech.	Japan	9.70	10.00	12.60	15.00
14	Dynamic Test Solutions	Singapore	12.40	12.00	10.80	11.16
15	T.I.P.S. Messtechnik	Europe	9.44	9.02	7.64	9.34
16	Hampoo	China	8.50	9.50	8.70	9.00
17	PWB Corporation	Japan	6.34	6.79	7.49	8.11
18	STEP SYSTEM	Korea	7.26	7.40	7.10	7.95
19	IT&T	Korea	6.35	6.10	6.80	7.55
20	GigaForce	China	6.60	6.50	6.70	7.00
21	Test21 Corporation	North America	4.00	3.90	4.50	5.60
22	SIENNA ECAD	Rest of World	5.25	5.00	4.95	5.15
23	Meritech	Korea	5.40	5.00	4.60	4.90
24	Dynalist Manufacturing	North America	2.70	2.80	3.20	3.70
25	Christian Enzmann	Europe	2.15	2.35	2.95	3.50
26	Finley Design Services	North America	3.10	3.30	3.20	3.50
27	Interface Technologies	Europe	1.80	2.00	2.90	3.35
28	DFW Test	North America	2.30	3.00	2.50	3.10
29	Phoenix PCB	North America	3.30	3.00	2.80	3.10
30	ATSPID	North America	2.00	2.50	2.85	3.00
31	Cibel	Europe	2.00	2.10	1.80	2.00
32	Contech	North America	1.50	1.80	1.60	2.00
33	M Specialties	North America	5.20	1.30	1.30	1.60
34	Salland Engineering	Europe	1.10	1.10	1.10	1.20
	Circuit Spectrum	North America	4.80	EX	EX	EX
	DDi Corp	North America	EX	EX	EX	EX
	Protos Electronics	North America	2.10	EX	EX	EX
	SaiBas Technologies	North America	1.00	EX	EX	EX
	SEMES	Korea	EX	EX	EX	EX
	Unicircuit	North America	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other		100.57	101.95	100.60	181.52
Total			519.29	538.44	559.59	706.88
Annual Growth				3.7%	3.9%	26.3%

Copyright © TechInsights Inc. All rights reserved.
Distribution rights contained in T&Cs.
August, 2022

(3)市場未來之供需狀況與成長性：

A.需求方面

人類的食、衣、住、行、娛樂及醫療與 IC 的連結性越來越高。且終端產品日愈輕薄化，IC 體積也日益縮小，在 IC 高階成本逐漸增加的趨勢下，作為 IC 良率把關重要一環的 IC 晶圓測試板與 IC 封裝測試板需求勢必增加。

B.供給方面

在半導體產業先進製程日益精進下，具備能提供高階 IC 測試測試卡板的供應商估計會越來越有少。加上與測試載板息息相關的探針卡與 IC 測試產業各廠商均有其專注擅長的領域，但隨技術的演進，若是供給者無法在技術上突破可能會逐漸被市場淘汰。本公司作為亞州地區有能力提供高

階 IC 測試載板供給者之一，將會持續投入研究開發先進製程技術，以維持市場的競爭力。

(4)競爭利基：

- A.快速的整合及完整的研發人力。
- B.結合半導體封裝技術，發揮綜效。
- C.嚴謹精實的材料與在製品庫存管理，降低客戶庫存風險。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

A.有利因素:

- a.擁有累積多年的研發測試核心技術以支援各項測試平台的認證產品。
- b. IC 產業將因應用面持續擴加，預估未來仍持續成長，有利公司營運成長。

B.不利因素與因應對策:

- a.同業競爭價格，對毛利形成壓力：
因應對策：嚴格控制成本，緊縮支出，並妥善運用生產設備重大投資及固定資產決策，使邊際效益極大化。
- b. PCB 委外採購，不利大量化訂單及成本結構
持續與多元供應商合作，分散供應風險及降低採購成本，並發展關鍵技術，提高客戶合作採用動機。
- c.國際經濟情勢仍不穩定，影響匯率變化。
因應對策：盡量使用本地材料，並尋找替代材料以分散風險。

2.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明：

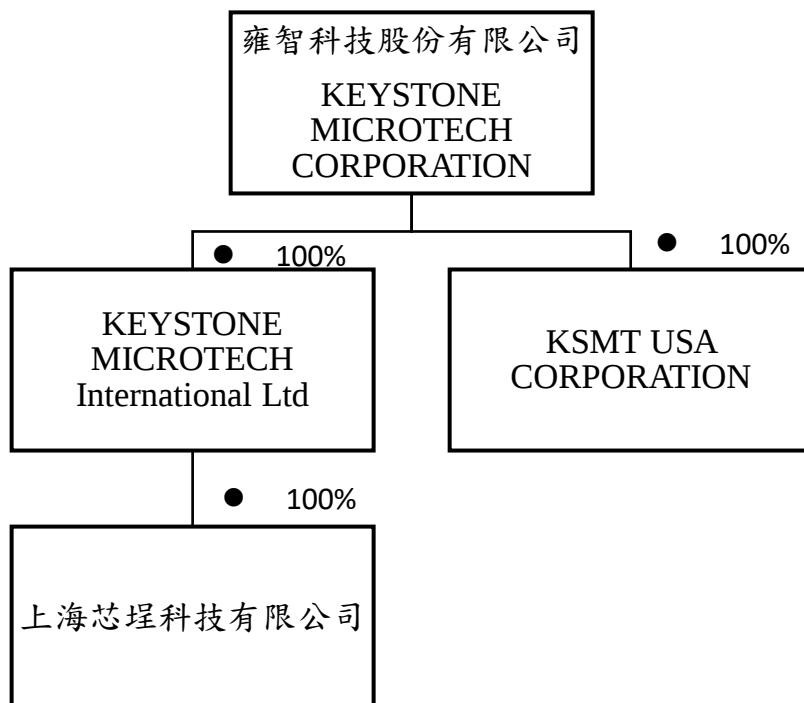
項目	111 年度	112 年度	變動比率
毛利率	48.91%	50.03%	+1.12%

112 年度及 110 年度其毛利率變動並未達 20%，故不擬分析價量差異。

二、轉投資事業

(一)轉投資事業概況

1. 關係企業組織圖



2.各關係企業基本資料

112 年 12 月 31 日；單位：元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
KEYSTONE MICROTECH International Ltd	112/3/23	Portcullis Chambers, P.O. Box 1225, Apia, Samoa	USD \$600,000	一般投資業務
上海芯埕科技有限公司	112/3/24	上海市嘉定區菊園新區 環城路 2222 號 1 幢 JT8471 室	RMB \$4,054,126	半導體測試零組件 銷售及提供技術諮詢 和技術服務
KSMT USA CORPORATION	113/03/08	28 N FIRST ST900 SAN JOSE, CA 95113	USD \$1,000,000	提供客戶半導體測試 技術諮詢及市場行銷

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

企業名稱	主要營業項目	往來分工情形
KEYSTONE MICROTECH International Ltd	一般投資業務	不適用
上海芯埕科技有限公司	半導體測試零組件銷售及提供技術諮詢和技術服務	半導體測試零組件銷售及提供技術諮詢和技術服務
KSMT USA CORPORATION	提供客戶半導體測試技術諮詢及市場行銷	提供客戶半導體測試技術諮詢及市場行銷

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

113 年 3 月 25 日

企業名稱	職稱	姓名或 代表人	所代表法人	持有股份	
				股數(股)	持股比例
KEYSTONE MICROTECH International Ltd	董事	李職民 (代表人)	雍智科技股份有限公司	600,000	100%
上海芯埕科技有限公司	執行董事	黃榮彬 (代表人)	KEYSTONE MICROTECH International Ltd	-	100%
	監察人	羅文陞	KEYSTONE MICROTECH International Ltd		
KSMT USA CORPORATION	董事	李職民	雍智科技股份有限公司	1,000,000	100%
	董事	劉安炫			
	董事	盧俊郎 (負責人)			

6. 各關係企業營運概況：

112 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
KEYSTONE MICROTECH International Ltd	18,423	10,441	0	10,441	0	0	(7,593)	(0.41)
上海芯埕科技有限公司	17,575	13,102	2,971	10,131	876	(8,091)	(7,596)	-
KSMT USA CORPORATION (註)	--	--	--	--	--	--	--	--

註: KSMT USA CORPORATION 於 2024/03/08 注資成立，截至刊印日尚無會計師核閱或查核財務資料。

7. 最近年度轉投資獲利或損失之主要原因及改善計畫：

本公司 112 年度採用權益法之投資損失為 7,593 仟元，因大陸子公司於 112 年度新設立，營運初期產生虧損。

8. 未來一年投資計劃：

將視本公司之營運需求，安排投資計劃。

(二)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：無此情形。

三、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約：

■ 民國 113 年 3 月 15 日董事會通過取得土地廠房案：

取得資產之公司	標的物名稱	取得日期				取得總價款	實際付款情形	交易對象	與公司之關係	取得目的	價格決定之參考依據(註1)
		訂約日	過戶日	公告日	董事會決議日						
土地及廠房	新竹縣竹北市泰和段	113/3/15	尚未	113/3/15	113/3/15	433,750仟元	第一期款2,702萬	保樂資產管理股份有限公司	非關係人	基於公司長期營運所需及擴充產能	力行不動產估價師事務所陳榮源估價師

參、發行計劃及執行情形

一、本次發行限制員工權利新股應記載事項

本次發行限制員工權利新股發行及認股辦法請詳附件一。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項

不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項

不適用。

肆、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一) 簡明資產負債表及綜合損益表

1. 採用國際會計準則

(1) 簡明合併資產負債表-採用國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)				
		108 年	109 年(註 2)	110 年(註 2)	111 年(註 2)	112 年
流 動 資 產		1,196,848	1,663,042	1,762,562	1,946,708	2,097,935
不動產、廠房及設備		314,061	339,432	460,747	459,015	439,793
使 用 權 資 產		2,921	4,763	6,888	7,059	8,851
投 資 性 不 動 產		86,571	86,571	-	-	-
無 形 資 產		13,893	23,437	15,798	9,046	5,306
其 他 資 產		14,687	40,020	37,268	34,941	28,855
資 產 總 額		1,628,981	2,157,265	2,283,263	2,456,769	2,580,740
流動負債	分 配 前	277,786	578,022	420,946	387,902	352,295
	分 配 後	169,483	429,106	209,756	183,710	(註 3)
非 流 動 負 債		313	2,667	2,481	7,658	5,752
負債總額	分 配 前	278,099	580,689	423,427	395,560	358,047
	分 配 後	169,796	431,773	212,237	191,368	(註 3)
歸屬於母公司業主之 權 益		1,350,882	1,576,576	1,859,836	2,061,209	2,222,693
股 本		270,757	270,757	270,757	272,257	272,177
資 本 公 積		286,140	286,140	298,616	325,166	323,750
保留盈餘	分 配 前	793,985	1,019,679	1,290,463	1,485,724	1,635,734
	分 配 後	685,682	870,763	1,079,273	1,281,532	(註 3)
其 他 權 益		-	-	-	(21,938)	(8,968)
庫 藏 股 票		-	-	-	-	-
非 控 制 權 益		-	-	-	-	-
股 東 權 益	分 配 前	1,350,882	1,576,576	1,859,836	2,061,209	2,222,693
	分 配 後	1,242,579	1,427,660	1,648,646	1,857,017	(註 3)

註 1：上述年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：本公司持股 100% 子公司銳萊科技股份有限公司（以下簡稱銳萊公司），已於 109 年 3 月 30 日經簡易吸收合併，併入本公司而消滅。本公司與銳萊公司之合併實質係屬組織重組，在吸收合併後，109 年至 111 年間本公司已無其他合併個體，惟因本公司吸收合併後之組織架構與吸收合併前之合併公司相同，故本公司 109 年至 111 年間之個別財務報告之財務資訊，與合併財務資訊一致可比較。

註 3：截至年報刊印日為止，112 年度之盈餘分配案尚未經股東會決議。

(2)簡明合併綜合損益表-採用國際財務報導準則

單位:新台幣仟元/惟每股盈餘為元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	108 年	109 年(註 2)	110 年(註 2)	111 年(註 2)	112 年
營 業 收 入	824,346	1,228,663	1,481,720	1,529,234	1,410,225
營 業 毛 利	451,316	704,672	805,523	747,940	705,599
營 業 損 益	261,659	436,329	540,722	446,837	423,097
營業外收入及支出	(8,916)	(23,523)	(13,998)	66,121	19,613
稅 前 淨 利	252,743	412,806	526,724	512,958	442,710
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	206,913	333,997	419,700	406,451	354,202
停 業 單 位 損 失	-	-	-	-	-
本期淨利 (損)	206,913	333,997	419,700	406,451	354,202
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	-	-	-	-	(217)
本期綜合損益總額	206,913	333,997	419,700	406,451	353,985
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	206,913	333,997	419,700	406,451	354,202
淨利歸屬於非控制 權 益	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬 於 母 公 司 業 主	206,913	333,997	419,700	406,451	353,985
綜合損益總額歸屬 於 非 控 制 權 益	-	-	-	-	-
每 股 盈 餘	7.85	12.34	15.50	15.01	13.07

註 1：上述年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：本公司持股 100%子公司銳萊科技股份有限公司（以下簡稱銳萊公司），已於 109 年 3 月 30 日經簡易吸收合併，併入本公司而消滅。本公司與銳萊公司之合併實質係屬組織重組，在吸收合併後，109 年至 111 年間本公司已無其他合併個體，惟因本公司吸收合併後之組織架構與吸收合併前之合併公司相同，故本公司 109 年至 111 年間之個別財務報告之財務資訊，與合併財務資訊一致可比較。

(3)簡明個體資產負債表-採用國際財務報導準則

單位:新台幣仟元/惟每股盈餘為元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	108 年	109 年(註 2)	110 年	111 年	112 年
流 動 資 產	1,171,623	1,663,042	1,762,562	1,946,708	2,087,211
採 用 權 益 法 之 投 資	24,385	-	-	-	10,441
不動產、廠房及設備	314,061	339,432	460,747	459,015	439,793
使 用 權 資 產	2,921	4,763	6,888	7,059	7,261
投 資 性 不 動 產	86,571	86,571	-	-	-
無 形 資 產	13,893	23,437	15,798	9,046	5,306
其 他 資 產	14,561	40,020	37,268	34,941	28,496
資 產 總 額	1,628,015	2,157,265	2,283,263	2,456,769	2,578,508
流 動 負 債	分配前	276,820	578,022	420,946	387,902
	分配後	168,517	429,106	209,756	183,710 (註 3)
非 流 動 負 債	313	2,667	2,481	7,658	5,752
負 債 總 額	分配前	277,133	580,689	423,427	395,560
	分配後	168,830	431,773	212,237	191,368 (註 3)
股 本	270,757	270,757	270,757	272,257	272,177
資 本 公 積	286,140	286,140	298,616	325,166	323,750
保 留 盈 餘	分配前	793,985	1,019,679	1,290,463	1,485,724
	分配後	685,682	870,763	1,079,273	1,281,532 (註 3)
其 他 權 益	-	-	-	(21,938)	(8,968)
庫 藏 股 票	-	-	-	-	-
非 控 制 權 益	-	-	-	-	-
股 東 權 益	分配前	1,350,882	1,576,576	1,859,836	2,061,209
總 額	分配後	1,242,579	1,427,660	1,648,646	1,857,017 (註 3)

註 1：上述年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：本公司持股 100%子公司銳萊科技股份有限公司，已於 109 年 3 月 30 日經簡易吸收合併，併入本公司而消滅。惟因本公司吸收合併後之組織架構與吸收合併前之合併公司相同，故本公司 109 年之後之個別財務報告之財務資訊，與原 108 年之前個別財務資訊一致可比較。

註 3：截至年報刊印日為止，112 年度之盈餘分配案尚未經股東會決議。

(4)簡明個體綜合損益表-採用國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	108 年	109 年(註 2)	110 年	111 年	112 年
營 業 收 入	820,502	1,228,663	1,481,720	1,529,234	1,410,103
營 業 毛 利	450,805	704,672	805,523	747,940	705,583
營 業 損 益	261,210	436,329	540,722	446,837	431,189
營業外收入及支出	(8,508)	(23,523)	(13,998)	66,121	11,521
稅 前 淨 利	252,702	412,806	526,724	512,958	442,710
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	206,913	333,997	419,700	406,451	354,202
停 業 單 位 損 失	-	-	-	-	-
本 期 淨 利 (損)	206,913	333,997	419,700	406,451	354,202
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	-	-	-	-	(217)
本 期 綜 合 損 益 總 額	206,913	333,997	419,700	406,451	353,985
每 股 盈 餘	7.85	12.34	15.50	15.01	13.07

註 1：上述財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：本公司持股 100%子公司銳萊科技股份有限公司，已於 109 年 3 月 30 日經簡易吸收合併，併入本公司而消滅。惟因本公司吸收合併後之組織架構與吸收合併前之合併公司相同，故本公司 109 年之後之個別財務報告之財務資訊，與原 108 年之前個別財務資訊一致可比較。

(二) 財務分析

1.採用國際會計準則之財務分析

(1)合併財務分析-國際財務報導準則

年 度 分析項目		最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)				
		108 年	109 年(註 2)	110 年	111 年	112 年
財務結構 %	負債占資產比率	17.07	26.92	18.54	16.10	13.87
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	430.23	465.26	404.20	450.72	506.70
償債能力 %	流動比率	430.85	287.71	418.71	501.86	595.51
	速動比率	322.97	182.78	278.77	360.02	485.36
	利息保障倍數	2,107.19	3,152.19	2,621.52	2,631.55	969.73
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.78	6.15	6.76	7.59	5.58
	平均收現日數	63.17	59.35	53.98	48.07	65.39
	存貨週轉率(次)	1.49	1.09	1.05	1.22	1.30
	應付款項週轉率(次)	4.33	3.73	4.84	8.21	8.92
	平均銷貨日數	245.09	334.86	347.61	299.18	281.46
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	2.62	3.76	3.70	3.32	3.14
	總資產週轉率(次)	0.60	0.65	0.67	0.65	0.56
獲利能力	資產報酬率(%)	15.01	17.65	18.91	17.15	14.08
	權益報酬率(%)	17.86	22.82	24.43	20.73	16.54
	稅前純益占實收資本比率(%)	93.35	152.46	194.54	188.40	162.66
	純益率(%)	25.10	27.18	28.33	26.58	25.12
	每股盈餘(元)	7.85	12.34	15.50	15.01	13.07
現金流量 %	現金流量比率	77.00	49.86	82.77	105.84	139.64
	現金流量允當比率	88.97	69.57	82.61	102.50	139.22
	現金再投資比率	10.13	11.55	10.13	8.95	11.81
槓桿度	營運槓桿度	1.99	1.77	1.68	1.91	1.95
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變

- 1.速動比率上升:主要係 112 年底流動性資產-現金及按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加，致使該比率上升。
- 2.利息保障倍數下降:主要係 112 年稅前利益減少，且利息費用增加，致使該比率下降。
- 3.應收款項週轉率(次)下降:主要係 112 年銷售淨額減少，且期末應收帳款增加，致使該比率下降。
- 4.平均收現日數上升:同上。
- 5.權益報酬率下降:主要係 112 年底股東權益增加，且 112 年稅後利益減少，致使該比率下降。
- 6.現金流量比率上升:主要係本年度期末存貨淨額減少，致使該比率上升。
- 7.現金流量允當比率上升:主要係本年度營業活動淨現金流量較去年增加，且本年度存貨增加數減少致使該比率上升。
- 8.現金再投資比率上升:主要係 112 年底流動性資產-現金及按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加，致使該比率上升。

註 1：上述年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：本公司持股 100%子公司銳萊科技股份有限公司（以下簡稱銳萊公司），已於 109 年 3 月 30 日經簡易吸收合併，併入本公司而消滅。本公司與銳萊公司之合併實質係屬組織重組，在吸收合併後，本公司已無其他合併個體，惟因本公司吸收合併後之組織架構與吸收合併前之合併公司相同，故本公司 109 年之後之個別財務報告之財務資訊，與原 108 年前之合併財務資訊一致可比較。

(2)個體財務分析-國際財務報導準則

分析項目 \ 年 度		最近五年度財務分析(註1)				
		108 年	109 年	110 年	111 年	112 年
財務結構 %	負債占資產比率	17.02	26.92	18.54	16.10	13.80
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	430.23	465.26	404.20	450.72	506.70
償債能力 %	流動比率	423.24	287.71	418.71	501.86	596.24
	速動比率	315.15	182.78	278.77	360.02	485.51
	利息保障倍數	2,106.85	3,152.19	2,621.52	2,631.55	1,433.72
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.79	6.15	6.76	7.59	5.58
	平均收現日數	63.04	59.35	53.98	48.07	65.39
	存貨週轉率(次)	1.48	1.09	1.05	1.22	1.30
	應付款項週轉率(次)	4.32	3.73	4.84	8.21	8.92
	平均銷貨日數	246.44	334.86	347.61	299.18	281.50
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	2.61	3.76	3.70	3.32	3.14
	總資產週轉率(次)	0.6	0.65	0.67	0.65	0.56
獲利能力	資產報酬率(%)	15.02	17.65	18.91	17.15	14.08
	權益報酬率(%)	17.86	22.82	24.43	20.73	16.54
	稅前純益占實收資本比率(%)	93.33	152.46	194.54	188.40	162.66
	純益率(%)	25.22	27.18	28.33	26.58	25.12
	每股盈餘(元)	7.85	12.34	15.50	15.01	13.07
現金流量 %	現金流量比率	77.46	49.86	82.77	105.84	142.11
	現金流量允當比率	88.27	69.57	82.61	102.50	137.71
	現金再投資比率	10.17	11.55	10.13	8.95	12.08
槓桿度	營運槓桿度	1.99	1.77	1.68	1.91	1.92
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20%者可免分析)

- 1.速動比率上升:主要係 112 年底流動性資產-現金及按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加，致使該比率上升。
- 2.利息保障倍數下降:主要係 112 年稅前利益減少，且利息費用增加，致使該比率下降。
- 3.應收款項週轉率(次)下降:主要係 112 年銷售淨額減少，且期末應收帳款增加，致使該比率下降。
- 4.平均收現日數上升:同上。
- 5.權益報酬率下降:主要係 112 年底股東權益增加，且 112 年稅後利益減少，致使該比率下降。
- 6.現金流量比率上升:主要係本年度期末存貨淨額減少，致使該比率上升。
- 7.現金流量允當比率上升:主要係本年度營業活動淨現金流量較去年增加，且本年度存貨增加數減少致使該比率上升。
- 8.現金再投資比率上升:主要係 112 年底流動性資產-現金及按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加，致使該比率上升。

資料來源：經會計師查核簽證之財務報表

註1：以上各期財務資料經會計師查核簽證。

註2：營業活動之淨現金流量為負數，不予計入。

註3：財務分析計算公式如下所列：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額

(2)長期資金占固定資產比率＝(股東權益淨額＋長期負債)／固定資產淨額

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債

(2)速動比率＝(流動資產－存貨－預付費用)／流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／不動產、廠房及設備淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝[稅後損益＋利息費用×(1－稅率)]／平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額

(4)每股盈餘＝(稅後淨利－特別股股利)／加權平均已發行股數

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝最近5年度營業活動淨現金流量／最近5年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其它資產＋營運資金)

6.槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)

二、財務報告應記載事項

(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告

1.111 年度財務報表暨會計師查核報告：詳附件三。

2.112 年度合併財務報表暨會計師查核報告：詳附件四。

(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告。

1.112 年度個體財務報表暨會計師查核報告：詳附件五。

(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：

無。

三、財務概況其他重要事項應記載事項

最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露資訊：無。

四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一)財務狀況

項目 \ 年度	111 年	112 年	差異	
			金額	%
流動資產	1,946,708	2,097,935	151,227	8
非流動資產	510,061	482,805	(27,256)	(5)
流動負債	387,902	352,295	(35,607)	(9)
負債總額	395,560	358,047	(37,513)	(9)
股本	272,257	272,177	(80)	(0)
資本公積	325,166	323,750	(1,416)	0
保留盈餘	1,485,724	1,635,734	150,010	10
權益總計	2,061,209	2,222,693	161,484	8

最近二年度增減比例變動分析說明：

1.流動資產增加：因期末之現金及應收帳款增加所致。

2.流動負債及負債總額減少：主要係 112 年期末合約負債-流動較去年減少，使流動負債及負債總額相對減少。

3.保留盈餘增加：主要係 112 年度盈餘增加所致。

(二)財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

1.經營結果比較分析表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	111 年度	112 年度	差異	
			金額	%
營業收入	1,529,234	1,410,225	(119,009)	(8)
營業成本	(781,294)	(704,626)	(76,668)	(10)
營業毛利	747,940	705,599	(42,341)	(6)
營業費用	(301,103)	(282,502)	(18,601)	(6)
營業淨利	446,837	423,097	(23,740)	(5)
營業外收入及支出	66,121	19,613	(46,508)	(70)
稅前淨利	512,958	442,710	(70,248)	(14)
所得稅費用	(106,507)	(88,508)	(17,999)	(17)
本期淨利	406,451	354,202	(52,249)	(13)
本期綜合損益總額	406,451	353,985	(52,466)	(13)

最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者：

營業外收入及支出減少：主要係 112 年度產生兌換損失 2,478 仟元，較 111 年產生兌換利益 62,610 仟元，減少 65,088 仟元所致。

2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

1.預計銷售數量與其依據：

依據全球和台灣 IC 產業動向及前端客戶預期，未來半導體市場 IC 相關應用仍不斷推陳出新，且台灣在半導體 IC 設計和晶圓製造、封裝測試全權佔有相當比重，雖然 2022 年下半年到 2023 年間，台灣半導體產業因需求減緩，去庫存化持續，但本公司預期未來 IC 產品的測試需求長期下將持續穩健成長。

2.對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

IC 產業景氣在全球新冠肺炎疫情逐步穩定後，2022 年下半年後產生半導體需求減緩，商品去庫存化情形延續到 2023 年，本公司半導體測試載板的服務有相當比例為工程研發測試使用，相對整體產業的影響較緩和。但長期半導體產業仍會不斷發展，尤其 2024 年開始 AI 高速發展，帶動高頻高速 IC；另電動車持續普及下，帶動產業車用 IC 需求，因此本公司長期營運及財務仍會隨台灣整體 IC 產業的成長而呈現正向的趨勢。

本公司為了提供客戶兼具成本效率及更完整可靠的解決方案及進一步尋求高成長的動力，除持續投入研發資源，與客戶共同開發對下一世代的先進測試製程技術及建構相關的測試實驗室環境，持續維持公司的未來的競爭力和營收成長。

(三)現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。

1.最近年度現金流量分析：

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	111 年度	112 年度	增(減)比例
營業活動淨現金流入(出)	410,594	491,949	20
投資活動淨現金流入(出)	(36,054)	(148,427)	(312)
融資活動淨現金流入(出)	(216,905)	(212,474)	2
增減比例變動分析說明：			
1.營業活動淨現金流入：112 年度較 111 年度營業活動淨現金流入增加，主要係存貨減少所致。			
2.投資活動淨現金流出：112 年度投資活動淨現金流出相較 111 年度增加，主要是 112 年取得按攤銷後成本衡量之金融資產所致。			
3.融資活動淨現金流出：112 年度融資活動淨現金流出相較 111 年度減少，主要係 112 年度發放現金股利較 111 年度減少所致。			

2.流動性不足之改善計畫：本公司資金尚屬充裕，未有流動性不足之情形。

3.未來一年(113 年度)現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初 現金餘額	預計全年 來自營業 活動淨現 金流量	預計來自投 資活動淨現 金流量	預計來自融資 活動淨現金流 量	預計現金剩 餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
1,307,168	407,531	(466,861)	(149,161)	1,098,677	—	—
1.未來一年度現金流量變動情形分析：						
(1) 營業活動淨現金流量：預計 113 年營收仍持續成長，產生正向營業活動淨現金流。						
(2) 投資活動淨現金流量：預計 113 年購買辦公室及土地，並持續投資資本支出。						
(3) 融資活動淨現金流量：預計 113 年盈餘分配發放 112 年之現金股利。						
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。						

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響

1.重大資本支出之運用情形及資金來源：基於公司長期營運所需及擴充產能，將於 113 年 3 月購置土地及廠房。資金來源係全部來自於公司營運所產生之資金，並未向外舉債。

- 2.預期可能產生效益：預計新廠辦大樓完工後，本公司整體營運管理預計將更有效率，並直接節省龐大租金支出及增加同仁的向心力。

(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1.本公司轉投資政策

本公司對轉投資事業之管理政策，除依內部控制制度中之投資循環規定辦理，另訂「取得或處分資產處理程序」、「對子公司監督與管理辦法」、「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」規範，作為轉投資事業控制及監督之依據，建立子公司營運風險管理機制，以發揮最大之經營績效。

2.最近年度轉投資獲利或損失之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司 112 年度採用權益法之投資損失為 7,593 仟元，因大陸子公司於 112 年度新設立，營運初期產生虧損。

3.未來一年投資計畫：將視本公司之營運需求，安排投資計畫。

(六)其他重要事項

無。

伍、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：

不適用。

二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：

不適用。

三、證券承銷商評估總結意見：

不適用。

四、律師法律意見書：

不適用。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：

請詳附件二。

六、本次募集與發行有價證券於申報生效時經本會通知應補充揭露之事項：

無。

七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：

無。

八、第一上市（櫃）公司及興櫃公司與我國股東權益保障規定重大差異之說明：

不適用。

十一、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1. 董事會運作情形資訊

最近年度 111 年度及 112 年度截至年報刊印日止董事會共開會 14 次。董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	李職民	14	0	100	-
董事	盧俊郎	14	0	100	-
董事	寬逸投資有限公司-法人董事代表人-李明義	14	0	100	-
董事	葉啟鴻	13	0	92.86	-
獨立董事	林江亮	14	0	100	-
獨立董事	陳啟文	14	0	100	-
獨立董事	陳金漢	14	0	100	-

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事姓名	議案內容	迴避原因	參與表決情形
盧俊郎	新聘任總經理人事任命案	本案涉及董事為被提名人，因有自身利害關係之虞，除依法應予以利益迴避外且不得加入討論及表決。	董事盧俊郎為被提名人，涉及自身利害關係而自行迴避不參與跟自身相關之討論與表決，經出席之其他無利害關係之董事一致無異議照案通過。
林江亮、陳啟文	聘任薪資報酬委員	本案涉及獨立董事為被提名人，因有自身利害關係之虞，除依法應予以利益迴避外且不得加入討論及表決。	獨立董事林江亮、吳松茂及陳啟文為被提名人，涉及自身利害關係而自行迴避不參與跟自身相關之討論與表決，經出席之其他無利害關係之董事一致無異議照案通過。
盧俊郎、李明義	本公司員工認股辦法暨 108 年度現金增資案-經理人獲配員工認股股數議案	本案涉及董事為經理人，因有自身利害關係之虞，除依法應予以利益迴避外且不得加入討論及表決。	董事盧俊郎及法人董事代表人-李明義為經理人，涉及自身利害關係而自行迴避不參與跟自身相關之討論與表決，經出席之其他無利害關係之董事一致無異議照案通過。

李職民、盧俊郎	總經理人事異動案	本案涉及董事人事案，因有自身利害關係之虞，除依法應予以利益迴避外且不得加入討論及表決。	本案之利害關係人李職民及盧俊郎董事於討論及表決時迴避，其餘董事討論後，經獨立董事林江亮徵詢其餘出席董事一致決定同意照案通過。
---------	----------	---	--

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請詳下表有關董事會評鑑執行情形。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一)本公司為符合公司治理精神，於 107 年 09 月 28 日自願設置審計委員會，行使證交法、公司法及其他法令之規定之職權。

(二)本公司於 107 年 04 月 18 日設置薪資報酬委員會，以利負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(三)提升資訊透明度：本公司網站設有「投資人關係」專區，提供發言人信箱，供股東諮詢公司財務、業務相關資訊，並將本公司財務資訊、重大議事決議等資訊均已依規定公佈在公開資訊觀測站，投資大眾均可即時獲得資訊。

2.董事會評鑑執行情形:

雍智科技每年針對董事會整體效能、董事成員績效及功能性委員會運作績效進行自我評估，且將其評估結果提報董事會，作為持續加強董事會運作之參考。2022 年 11 月 7 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估，以加強董事會運作效能。2024 年 3 月 4 日薪酬委員會、審計委員會及董事會對 2023 年之自我績效評估的結果得分分別為 88.89%、97.6% 與 93.7%。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112/01/01 至 112/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事成員自評、同儕評估	(1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 (3) 功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(二) 審計委員會運作情形

1. 依本公司審計委員會組織規程第六條規定，審計委員會之職權事項如下：

- (1)、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)、內部控制制度有效性之考核。

- (3)、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處埋程序。
- (4)、涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)、重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11)、其他公司或主管機關規定之重大事項。

2. 審計委員會運用情形：

本公司於民國 107 年 09 月 28 日設置審計委員會。本公司最近年度 111 年度及 112 年度截至年報刊印日止，審計委員會共召開 12 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	林江亮	12	0	100	-
獨立董事	陳啟文	12	0	100	-
獨立董事	陳金漢	12	0	100	-

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：無。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

會議日期	議案內容	溝通結果
111.03.07	110 年第 4 季內部稽核執行情報告 審閱 110 年內部控制制度聲明書	全體出席獨立董事無意見。
111.05.09	111 年第 1 季內部稽核執行情報告	全體出席獨立董事無意見。
111.08.08	111 年第 2 季內部稽核執行情報告	全體出席獨立董事無意見。
111.11.07	111 年第 3 季內部稽核執行情報告	全體出席獨立董事無意見。

	審閱 112 年度稽核計畫	
112.03.06	111 年第 4 季內部稽核執行情報告 審閱 111 年內部控制制度聲明書	全體出席獨立董事無意見。
112.05.08	112 年第 1 季內部稽核執行情報告	全體出席獨立董事無意見。
112.08.07	112 年第 2 季內部稽核執行情報告	全體出席獨立董事無意見。
112.11.03	112 年第 3 季內部稽核執行情報告 審閱 112 年度稽核計畫	全體出席獨立董事無意見。
113.03.04	112 年第 4 季內部稽核執行情報告 審閱 112 年內部控制制度聲明書	全體出席獨立董事無意見。

3. 審計委員會年度工作重點彙整及當年度運作情形:

會議日期	議案內容
111.03.07	1.通過 110 年內部控制制度聲明書 2.通過本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報告案。 3.通過本公司 111 年度財務報表簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 4.通過新訂定公司之「永續發展實務守則」及修訂定「公司治理實務守則」案 5.通過修訂定本公司「取得或處分資產處理準則」案 6.通過修訂定本公司「股東會議事規則」案
111.05.09	1.通過 111 年第 1 季財務報告案報告案 2.通過修訂定本公司「股東會議事規則」案
111.05.17	通過購置土地及廠房案
111.08.08	通過 111 年上半年度財務報表案
111.11.07	1.通過 111 年第 3 季財務報表案 2.通過 112 年度稽核計畫
112.03.06	1.通過 111 年內部控制制度聲明書 2.通過本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告案。 3.通過 112 年度財務報表簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 4.通過修訂「董事會議事規範」案 5.通過發行限制員工權利新股案
112.05.08	通過本公司 112 年第 1 季財務報表案
112.08.07	通過 112 年上半年度財務報表案
112.11.03	1. 修訂「會計制度」案 2. 通過檢視超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之是否屬資金貸與性質案 3.通過 111 年第 3 季財務報表案 4.通過 112 年度稽核計畫
112.12.01	1.通過投資新設成立雍智科技(美國)有限公司之轉投資案

113.03.04	1.通過 112 年內部控制制度聲明書 2.通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案。 3.通過 113 年度財務報表簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 4.通過修訂「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案 5.通過預先核准非確信服務之相關辦法 6.通過檢視超過正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之是否屬資金貸與性質案 7.通過發行限制員工權利新股案 8.通過透過在 Samoa 的 100%持有子公司 KEYSTONE MICROTECH International Ltd 轉增資大陸地區孫公司上海芯埕科技有限公司案
113.03.15	通過購置土地及廠房案

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露 公司治理實務守則？	V		本公司已訂定公司治理實務守則，並揭露於公司網站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 公司設有發言人及代理發言人負責處理相關事宜。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 由專業的股務代理機構負責。並設有股務人員 處理相關事宜。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司已制定「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」等具體書面財務業務作業辦法，以規範與關係企業間之往來事項。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司訂有防範內線交易之管理辦法。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因																					
	是	否	摘要說明																						
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(一)本公司董事會成員均在各領域有所專長，如財務會計、半導體產學、法律專才，就公司部門營運提出卓見和監督。 (二)公司設置薪資報酬委員會及審計員會，將來視實際需要斟酌辦理。 (三)本公司尚未制度，但已經依相關作業執行並提報董事會。 (四)本公司董事會每年均進行對會計師適任性及獨立性之評估。參酌審計品質指標(AQIs)及會計師法第 47 條及中華民國會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」訂定本公司之會計師適任性及獨立性評估表。112年3月6日及113年3月4日董會曾經評估後，委任簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，可確認簽證會計師符合獨立性，出具之財務報告之可信賴度無虞。	無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異																					
續三、(四)			<table><tr><th>評估項目</th><th>是</th><th>否</th></tr><tr><td>1.非為公司或關係企業之受僱人。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或 其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過 百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	評估項目	是	否	1.非為公司或關係企業之受僱人。	☒	☐	2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或 其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過 百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。	☒	☐	3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	☒	☐	4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	☒	☐	5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。	☒	☐	6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理	☒	☐	同上
評估項目	是	否																							
1.非為公司或關係企業之受僱人。	☒	☐																							
2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或 其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過 百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。	☒	☐																							
3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	☒	☐																							
4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	☒	☐																							
5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。	☒	☐																							
6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理	☒	☐																							

評估項目	運作情形					與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明			
			事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。			
			7.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	■		
			8.未有公司法第30 條各款情事之一。	■		
			9.未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	■		
			10.最近二年內不得擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	■		
			11.不得涉及本公司制定決策之管理職能。	■		
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已在111年3月7日董會通過設置公司治理主管，由財會主管兼任，作為公司治理單位，負責公司治理相關事務。包括：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會 及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料。			無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		設有利害關係人聯絡專員處理相關事宜，並於公司網站提供聯絡方式。			無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		公司委任專業股務代辦機構辦理。			無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V		(一)已架設公司之網站，建置揭露財務業務及公司治理資訊。可藉公開資訊觀測站揭露公司之相關資訊。 (二)公司設有發言人及代理發言人負責資料蒐集、揭露和對外溝通之橋樑。 (三)公司依照相關規定期限前提早公告並申報財務及營收資訊。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一)員工權益：本公司對員工之權益皆依勞基法加以保障，並與員工分享經營成果。 (二)僱員關懷：本公司對員工之生活及福利極為重視，不定期舉辦教育訓練、生日月會並有健診補助及團體保險等。亦定期舉辦員工旅遊或提供旅遊補助。 (三)投資者關係：設置發言人處理股東建議事項。 (四)供應商關係：本公司與供應商皆維持良好之關係。 (五)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 (六)董事及監察人進修之情形：本公司董事及監察人皆為學有專精、經驗豐富之專業人士擔任，每年均依規定時數，持續參加進修課程及申報。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：不適用。 (八)客戶政策之執行情形：不適用。 (九)公司為董事購買責任保險之情形：每年辦均投保董事責任保險及辦理相關申報。	無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。公司持續強化財務業務及公司治理相關資訊於公司網站之揭露，提升公司治理品質，以強化公司之競爭力。				

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料:

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事	林江亮	請參閱： 二、4.董事或監察人所具專業知識及獨立性之情形中有關獨立董事之揭露。			3	-
	陳啟文				-	-
	陳金漢				1	-
	林江亮				3	-

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊:

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)薪資報酬委員會職責:

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

A.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬及配合物價指數之變動與營運獲利情況，評估上述對象薪資之調整。

(3)本屆委員任期：110年8月2日至113年8月1日，最近年度111年度及112截至年報刊印日止，薪資報酬委員會共開會7次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
委員	林江亮	7	0	100%	-
委員	陳啟文	7	0	100%	-
委員	陳金漢	7	0	100%	-

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。

(4) 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

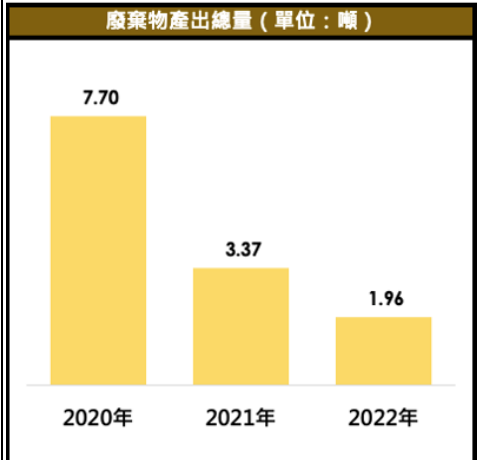
會議日期	議案內容	決議結果
111.03.07	審議110年度員工(含經理人)酬勞及董事酬勞分配案	經全體出席委員同意通過。
111.11.07	審議111年度經理人年終獎金及酬勞分配案	經全體出席委員同意通過。
112.03.06	審議111年度員工(含經理人)酬勞及董事酬勞分配案	經全體出席委員同意通過。
112.09.22	審議本公司新聘任總經理人事任命案之聘任合約	經全體出席委員同意通過。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司業經111年3月7日董事會通過「永續發展實務守則」，由總經理室統籌規劃，並由董事會監督。未來規劃每年定期向董事會報告執行成果以及未來一年度規劃之策略及目標。	未來年度規劃之策略及目標擬向董事會報告執行情形。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司依據永續報告書之重大性原則進行分析，經彙總重要利害關係人關注度、永續議題對雍智科技的經濟／環境／社會之營運衝擊度與可能性進行綜合性評估，列出誠信經營、資訊安全、品質管理、氣候策略、產品責任、人才吸引與留才、人力資本發展等7項重要揭露議題，列為2022年永續報告書揭露之依據。並訂定相關風險管理政策，有關重大議題之風險評估及風險管理策略請參閱下表(五之一)重大議題之風險評估及風險管理策略。	無重大差異
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 環境管理、用水量及廢棄物總重量管理：本公司產業特性屬半導體封裝測試之一環，主要從事各類IC測試載板之供應商，遵守各項環保及相關規定。雍智科技秉持環境友善理念，致力於日常營運中落實節能減碳，降低企業經營對自然環境之衝擊。針對能源管理，於總部辦公大樓實施空調與照明之節電措施，進而降低溫室氣體排放。水資源管理部份，於製程超純水產生之廢水、空調冷凝水均進行回收作為總部生活用水沖廁或澆灌等利用。廢棄物管理部分，針對一般廢棄物，於平日落實及宣導垃圾分類、回收，盡可能降低	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V			無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V			無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V			無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
續三、(四)			一般廢棄物產生；此外，事業廢棄物主要為報廢電路板、有機溶劑等，每年委託具備甲級處理許可證證照之廠商清運處理。具體作為請詳閱下表(五之二) 環境管理。 (二) 能源與溫室氣體管理： 本公司營運活動之能源使用，主要為新竹總部廠辦之公用設備、空壓機、冷卻水塔、冰水主機等設備，包含燃料（柴油、車用汽油）使用與廠辦電力耗用，最主要能源使用以廠辦電力為大宗。2022 年能源耗用 6,354.55 GJ 相較 2021 年 6,024.36 GJ 增加 5.4%。以樓地板面積（M2）計算之單位能源耗用強度計算，2022 年單位能源耗用強度為 4.91 GJ/樓地板面積M2，較 2021 年上升，主因為 2022 年產量上升故用電量增加 5%所致。 本公司溫室氣體排放有2大來源，主要為營運所需之外購電力在發電過程中所產生之二氧化碳，次要項目則為內部作業活動中使用之柴油所造成的溫室氣體，其中外購電力排放源占雍智科技整體排放量99.99%。規劃2024年底前進行溫室氣體盤查。 本公司為響應政府綠能政策，亦提早因應氣候相關風險，目前於辦公大樓5樓露台設置太陽能發電系統達發電量30 kW。與台電簽躉購合約購售電費率為5.5709元/度。目前售出電能均導回總部建物使用。未來預計於頂樓擴大太陽能發電、預計	同上

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
續三、(四)			總發電量可達66 kW。此外，雍智科技之水瀧辦公室屋頂光電面積正評估採用太陽能發電之可行性。 (三) 水資源管理： 本公司為瞭解水資源風險情形，以世界資源研究院（WRI）水風險評估工具，透過 Aqueduct 網站之「Aqueduct Water Risk Atlas」，依據台灣水資源分布情況進行分析，瞭解雍智科技新竹總部係位於水資源壓力低風險地區。水資源風險雖低，雍智科技仍進行水資源管理項目，如以廢水回收池，回收超純水的廢水和空調冷凝水回收，且定期進行水質檢測，將前述回收廢水用於廁所沖水及澆灌植物使用等，2022 年啟用雨水回收系統，回收雨水循環使用。雍智科技總部廠辦主要用水分為製程用水、消防用水與生活用水，水源均來自於自來水廠供水。近兩年用水量請參考(五之三) 水資源管理。 (四) 廢棄物管理： 本公司為持續強化廢棄物管理，且針對廢棄物減量進行管理，落實廢棄物之分類、回收、再利用及妥善處理。此外，持續管理廢棄物儲存、運送及處理，以降低對環境之衝擊。雍智科技挑選合格廢棄物清理及再利用的合作廠商，且透過不定期稽核廢棄物清除過程以確認其合法性，負起監督之責任。本公司廢棄物種類可分為一般事業廢棄物（D 類）、有害特性認定廢棄物（C 類）、混合五金廢料（E 類）等三大類，均為無現場處理	同上

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
			之離場處理。2022 年廢棄物合計 1.96 噸，相較於 2021 年下降 42%，主因為 2021 年製程變更，改為單一有機溶劑－異丙醇（IPA），且調整 IPA 更換時間由原本 15 天延長至 20 天，且為持續強化廢棄物減量，2022 年 10 月起，裝設 IPA 回收機器，目的將 IPA 回收自用，亦可減少廢棄物處理量，設置 62 公升、回收率 94%、2022 年 11 月至 12 月間，共計減量 0.09 公噸，故有機溶劑廢棄量持續下降。近三年廢棄物總重量如下。 廢棄物產出總量（單位：噸） <table><thead><tr><th>年份</th><th>產出總量（噸）</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020年</td><td>7.70</td></tr><tr><td>2021年</td><td>3.37</td></tr><tr><td>2022年</td><td>1.96</td></tr></tbody></table>	年份	產出總量（噸）	2020年	7.70	2021年	3.37	2022年	1.96	
年份	產出總量（噸）											
2020年	7.70											
2021年	3.37											
2022年	1.96											
四、社會議題 （一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		（一）為提供平等與健康之工作環境，於雇用方面禁止任何歧視行為，不因員工之種族、年齡、性別、性傾向、殘疾、懷孕、政治、宗教而有所歧視。所有員工皆依法簽定勞動契約，並於工作規則中明訂不得禁止工作者 集會結社	無重大差異								

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		自由、不雇用童工及不強迫勞動等規定，以保障其工作者之基本人權。在臺灣地區若遇特殊狀況須與員工終止勞動契約，則依照勞動基準法進行資遣預告及後續相關資遣費支付。2022年度未有強制勞動之情事發生，亦無與人權及強制性勞動有關之申訴案件。 (二) 本公司福利涵蓋健康、生活、節慶、保險等面向，提供員工所需之福利項目。除了依據政府法令為每位員工投保勞工保險及全民健康保險外，亦為每位員工全額負擔團體保險費用，保障內容涵蓋壽險、意外傷害險、醫療險及癌症險等。讓員工在發生意外或傷病時，能享有完善的醫療照顧、撫卹及經濟上之保障。員工亦可以優惠的保險費率，為家人投保公司的團體保險，讓眷屬也能同樣享有公司提供的保障。針對海外出差同仁，均主動投保高額的旅行平安險，以提供同仁更充分的保障。 自2005年7月1日勞工退休金條例實施後，本公司全體員工皆適用新制。公司每月依員工薪資6%提撥至勞工保險局之個人退休金帳戶，及依員工意願協助配合自願提繳作業。 雍智科技設置職工福利委員會，由各部門推派代表所組成，負責統籌、規畫及執行公司各項福利措施，期提供員工良好的工作環境與兼顧員工的身心健康，進而達成工作與生活平衡的目標。 依照本公司內控制度薪資管理辦法作業，視公司營運情形及員工個人績效表現調整薪酬	無重大差異
	V			無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境， 並對員工定期實施安全與健康教育？	V		給付及個人升遷。 (三)依職業安全衛生管理辦法設置職業安全衛生委員會，其委員會組成以董事長為主任委員、公司各單位主管擔任當然委員與勞工代表，共計9名委員組成，其中勞工代表人數3人，占比33%。委員會每季定期召開會議討論職業安全衛生環保規畫與執行事項，2022年共計開會4次。且雍智科技設有甲種職業安全衛生主管1人，定期檢討與推動職業安全衛生環保相關事項。此外公司不定期舉辦員工健康檢查，並於每年舉辦消防安檢、消防講習及演練、加強員工工作安全之教育訓練與宣導。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)公司重視人才訓練與發展，依各部門依性質辦理教育訓練及課程。透過專業的課程培訓，充實員工的專業知識與技能，進而達成公司所賦予的目標與任務，更協助員工有機會去探索、開發自我，接受挑戰，期與員工共同成長。	無重大差異 同上
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五)產品與服務之行銷及標示，公司皆遵循相關法規。此外，本公司由行銷業務單位執行管理服務客戶及處理客訴，定期檢討客戶對產品及服務的回饋，以完善管理公司的產品與服務品質與建立改善預防機制。為針對客戶的反饋擬定完整的執行改善計畫，未來規畫每年年底由業務負責進行線上客戶滿意度調查問卷，以利優化內部流程與產品改善創新。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？			(六)公司與供應商合作共同致力推動環保方向，遵守各項政策以善盡企業社會責任。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司於2022 年編制企業永續報告書，依循全球報告倡議組織（The Global Reporting Initiative , GRI）由全球永續性標準委員會（Global sustainability standard board , GSSB）發布之GRI永續報告準則（GRI Sustainability Reporting Standards,GRI Standards），同時依據永續會計準則（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）之科技與通訊（Technology and Communications）領域的半導體（Semiconductors）產業標準所撰寫。前揭報告書尚未取得第三方驗證單位查證。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：不適用。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 參與社會公益：本公司公益捐獻範疇，包含地區廟宇、地區教會、慈善社會公益機構的愛心捐款，2023年及2022年分別為新台幣173萬及213萬元。未來除了持續針對社區型服務機構及社會公益機構捐助外，鼓勵員工投入社區服務。				

(五之一)重大議題之風險評估及風險管理策略：

重大議題	重大主題	管理作為
能源管理	302 能源 2016	● 持續落實節能減碳管理，期望達到年減少 1%節電量 ● 空壓機能效改善、空調系統冷卻泵、水塔風扇、溫度調整設定，降低機組耗能 ● 總部燈具替換為高效率節能燈具 ● 設置職工福利委員會，定期統籌、規畫及執行公司各項福利措施
溫室氣體管理	305 排放 2016	
人才吸引與留任	401 勞雇關係 2016	
人才發展	404 訓練與教育 2016	

人權	406 不歧視 2016	● 提供員工所需之福利項目涵蓋健康、生活、節慶、保險等面向，此外針對海外出差同仁，投保高額的旅行平安險
產品責任 (品質管理)	416 顧客健康與安全 2016	● 導入 MES 製造管理系統，即時提供各製程正確的數據、統計與整合資訊，使管理階層掌握與控管 ● 導入自動光學檢測，改善人員漏檢、檢驗標準之問題，提升品質穩定度與效率
供應鏈管理	308 供應商環境評估 2016	● 進行稽核評級、風險分類與輔導
創新管理	創新管理	● 建立先進的高頻高速實驗室設備（高速毫米波實驗室） ● 針對射頻與高速應用、電領域、熱與機械應力機電整合分析領域持續投入研發與創新，能提供完整最適合解決測試方案
產品生命週期管理	產品生命週期管理	
廢棄物管理	306 廢棄物 2020	● 改用單一有機溶劑，異丙醇更換時間延長，故使用量大幅下降 ● 製程將於 2023 年導向無鉛製程，以利達到化學品減量與環境友善
職業安全衛生	403 職業健康與安全 2018	● 定期召開職業安全衛生委員會，檢討與推動職業安全衛生環保相關事項 ● 已建立緊急應變措施管理計畫，2022 年緊急演練 2 次、消防演練 2 次 ● 2022 年全體員工與承攬商皆無工傷或職業病等情事

(五之二) 環境管理：

能源與溫室氣體管理		水資源管理	廢棄物管理	化學品管理	空品管理
策略	持續落實節能減碳管理，期望達到年減少 1% 節電量	持續減少水資源浪費	持續廢棄物減量	2023 年製程導入 30% 的無鉛製程	持續提升室內空氣品質
作為	➢ 新竹總部皆採用 LED 照明 ➢ 調整地下停車場及各樓層燈管數量，減少非必要燈源浪費。 ➢ 新設 100 HP 變頻高效率空壓機組改善	➢ 雨水回收池、空調冷凝水、製程超純水產生之廢水，均回收作為沖廁、澆灌等水資源再利用。 ➢ 廁所設備使用具有省水標章水龍頭、	➢ 平日嚴格落實及宣導垃圾分類、回收 ➢ 每年委託具備甲級處理許可證證照之廠商清運處理 ➢ 2022 年導入 IPA 回收機，減少 IPA 購入及廢棄量。	➢ 增訂危害性化學品評估及分級管理辦法 ➢ 建立化學品管制清單及物質安全資料表，且定期維護與更新	➢ 新竹總部各層進行全熱交換器改善，將密閉空間內的廢氣排出室外，控制二氧化碳濃度，改善室內空氣品質

	老舊空壓機氣量及 能效不足問題 ➤ 空調系統冷卻泵、 水塔風扇、溫度調 整設定降低機組耗 能	小便斗及馬桶等器 具		➤ 危害性化學品均依 法進行標示管理 ➤ 個人防護具管理， 提供個人防護具使 用資訊。 ➤ 建立化學品的工作 環境作業危害之辨 識與風險管控 ➤ 人員暴露評估管理	
--	---	---------------	--	---	--

(五之三) 水資源管理：

淡水-第三方用水	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
取水量統計（單位：ML）	3.96	4.59	5.10	5.87

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(一) 本公司訂有「誠信經營守則」並由稽核室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。	無重大差異
	V		(二) 本公司訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」提供為公司經營重要事務人員的行為規範，內部稽核人員並定期查核，並於「工作規則」明定所有員工均應清楚了解且遵守從業道德規範及個人誠信，並秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務。	無重大差異
		V	(三) 本公司訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」，明定相關作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。本公司訂有完善的違規懲戒及申訴制度，且落實於公司網站設置「利害關係人聯絡窗口」專頁。	不適用
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(一) 本公司對往來之客戶及供應商均有評核機制，訂立合約時，對雙方的權利義務均詳訂其中並保密。	無重大差異
		V	(二) 本公司推動企業誠信經營相關宣導有人資單位及稽核單位負責。由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會責任。	無重大差異
	V		(三) 本公司設有人資及稽核單位，可提供檢舉人檢舉的陳述管道並對檢舉人身份及內容應保密。	無重大差異
	V			無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？		V	(四)本公司訂定有內部稽核計畫，內部稽核單位均依稽核計畫執行各項查核作業。 (五)尚未舉辦。	不適用
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？		V V V	(一)本公司尚未訂定具體檢舉及獎勵制度，但設有利害關係人聯絡人及檢舉信箱於公司網頁。 (二)本公司尚未訂定。 (三)不適用。	無重大差異 不適用 不適用
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司依相關法規揭露各項相關資訊於公開資訊觀測站外，並於公司網站揭露誠信經營守則內容。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 1.公司誠實經營，遵循稅務治理原則，現金有效稅率2019-2022年 落在區間18.89% -21.41% 間。 2.獲財政部表揚112年度績優營業人，獲獎率為萬分之3，且近年無任何違反環保建築法令情形。 https://udn.com/news/story/7324/7418027				

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式

1. 公司治理守則及相關規章

本公司已訂定「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」、「獨立董事職責範疇規則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」等相關規章，相關內容已揭露在公司網站。

2. 本公司「利害關係人專區」建置完成，相關之規章會索引至公開資訊觀測站適當位置供投資人查詢。

(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	盧俊郎	107.5.29	111.3.7	職務調整，轉任公司技術長

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

本公司董事會通過委任財務部林經理擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃。

陸、附件

附件一

限制員工權利新股發行辦法



雍智科技股份有限公司
一一二年度第一次限制員工權利新股發行辦法

第一條：發行目的

本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益，依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱處理準則)等相關規定，訂定本公司「一一二年度第一次限制員工權利新股發行辦法」(以下簡稱本辦法)。

第二條：發行期間

自主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

第三條：發行總額

預定不超過普通股 180,000 股，每股面額 10 元，預計發行總額不超過新台幣 1,800,000 元內。

第四條：員工之資格條件

- 一、以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限，並符合一定績效表現之員工，且將限於須對本公司營運決策有重大影響之員工，或對本公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。
- 二、實際得被授與員工及其可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬定分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後提報董事會通過；惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意，再提董事會決議；非具經理人身分者，應先經本公司審計委員會同意，再提董事會決議。
- 三、單一員工被授與之股數，係依處理準則第六十條之九「本公司依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司已依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一」之規定辦理。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。

第五條：發行條件

- 一、發行價格：每股以新台幣 0 元發行，即無現金對價之無償配發員工。
- 二、發行股份之種類：本公司普通股新股。
- 三、既得條件

員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：

(一)於各既得期間屆滿日仍在職；

1. 於限制員工權利新股發行日後滿一年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例：25%。
 2. 於限制員工權利新股發行日後滿二年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例：25%。
 3. 於限制員工權利新股發行日後滿三年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例：25%。
 4. 於限制員工權利新股發行日後滿四年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例：25%。
- 上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。

(二)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事；

(三)於各既得期間內達成本公司所設定之個人工作績效評核指標。

個人工作績效評核指標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核評等至少為甲等(含)以上。

四、員工獲配或認購限制員工權利新股後，遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回已獲配股數並予以註銷，其他發生繼承等例外情形時，應依下列方式處理：

(一)員工因故辦理離職、退休或資遣時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於該等事由生效日起即喪失受領股份之資格，本公司將無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。

- (二) 因受職業災害致身體殘疾或死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理：
1. 員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。
 2. 員工因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。
 3. 員工非因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。
- (三) 員工經由公司核准辦理留職停薪者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股得於復職後恢復權益，惟其獲配限制員工權利新股之既得期間應依其辦理留職停薪期間遞延之。
- (四) 因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者，如轉任當年度符合本辦法第五條規定之其他既得條件，得由董事長或其授權主管人員於本辦法第五條約定之時程比例範圍內，核定其達成既得條件之比例及時限。
- (五) 對於已達成既得條件而得領取的限制員工權利新股，員工或其繼承人應依本辦法及第六條第一項之信託約定受領。如因公司作業需要，員工本人或繼承人有須配合辦理股份領取作業，員工本人或繼承人應自本公司依本辦法通知領取之日起一年內配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為員工或其繼承人拒絕受領，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
- 五、 員工違反本公司服務契約、工作規則時，本公司得依情節之輕重向該員工無償收回尚未既得之股份(包含其股票股利)並辦理註銷。
- 六、 如員工終止或解除本公司就限制員工權利新股發行之委託辦理信託保管之代理授權時，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
- 七、 對於公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將予註銷。
- 八、 併購之處理
尚未既得股票應由併購相關契約或計畫約定變更。

第六條：員工獲配新股後未達成既得條件前受限制之權利如下：

- 一、 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)，於未達成既得條件之前，應先全數交付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
- 二、 除前項保管約定限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)，針對尚未達成既得條件之股份，除因本辦法發生繼承情事外，員工均不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
- 三、 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
- 四、 員工未達既得條件前於本公司股東會之出席提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
- 五、 於既得期間內，如本公司辦理非因法定減資之減少資本時，限制員工權利新股應依減資比例註銷。承上，如本公司係辦理現金減資，本公司因此所退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若員工未達既得條件時，本公司將收回該等現金。

第七條：股票信託保管事項

限制員工權利新股發行後須立即交付信託保管，未達既得條件前因持有限制員工權利新股之現金股利無須交付信託保管。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將獲配之股票自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。

第八條：簽約及保密

獲配限制員工權利新股之員工，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公司認為情節重大者，對於尚未達

成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失受領股份之資格，本公司有權無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。

第九條：稅賦

依本辦法所獲配之限制員工權利新股其相關之稅賦按中華民國法令規定辦理。

第十條：實施及修訂

- 一、 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報主管機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。
本辦法於中華民國 112 年 3 月 6 日董事會決議通過訂立。
第一次修訂於中華民國 113 年 4 月 9 日。
- 二、 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

附件二

會計師複核案件檢查表彙總意見

附件三

111 年度財務報表暨會計師查核報告

附件四

112 年度合併財務報表暨會計師查核報告

附件五

112 年度個體財務報表暨會計師查核報告

雍智科技股份有限公司



負責人：李職民

